



Always seeking better ways

株式会社 東京精密 アニュアルレポート 2007

## 財務ハイライト

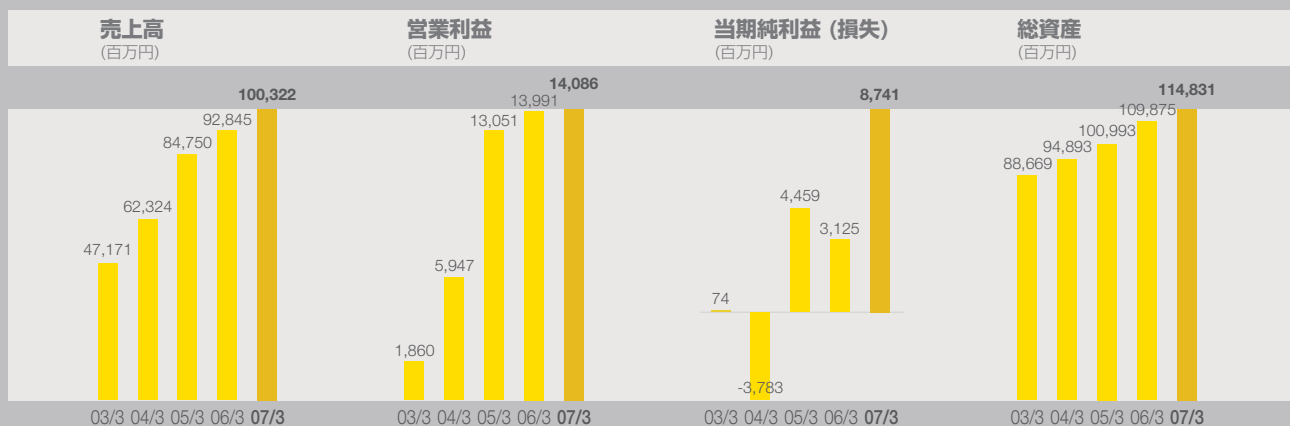
株式会社東京精密及び連結子会社  
2006年及び2007年3月31日に終了した年度

会計年度：	百万円		千米ドル		増減(%)
	2006	2007	2007		
売上高	¥ 92,845	¥ 100,322	\$ 849,544		8.1%
半導体製造装置	71,824	78,091	661,291		8.7
計測機器	21,020	22,230	188,252		5.8
営業利益	13,991	14,086	119,285		0.7
税金等調整前当期純利益	7,865	13,198	111,766		67.8
当期純利益	3,125	8,741	74,023		179.7
設備投資	3,978	2,511	21,266		(36.9)
減価償却費	2,768	2,882	24,405		4.1
研究開発費	7,919	7,638	64,687		(3.5)
半導体製造装置	7,296	6,844	57,961		(6.2)
計測機器	623	794	6,725		27.4

会計年度末：	百万円		千米ドル		増減(%)
総資産	¥ 109,875	¥ 114,831	\$ 972,407		
純資産	46,703	54,281	459,665		16.2

1株当たり(円及びドル)：	円		米ドル		増減(%)
当期純利益－希薄化前	¥ 80.77	¥ 217.91	\$ 1.85		
年間配当額	40.00	50.00	0.42		25.0

注：米ドル金額は2007年3月31日における換算レート、すなわち1米ドル118円09銭で便宜上換算している。



3月31日で終了した年

### 見通しに関する注意事項

このアニュアルレポートに掲載されている東京精密の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実ではない事柄は、将来の業績に関する見通しであり、リスクや不確実性を含んでいます。リスクや不確実性には、経済の動向、当社の事業領域の市況、為替変動、急速な技術革新による競争の激化などがあります。このような事象により、実際の業績はこれら見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。

東京精密（ACCRETECH）は、計測機器および半導体製造装置メーカーとして、お客様の生産性向上に寄与する最先端の製品開発とカスタマーサポートを提供しています。技術革新が激しく進行する環境下、高成長・高収益のビジネス基盤を構築し、さらなる企業価値向上に努めています。

当社の行動指針は「WIN－WINの仕事で世界No.1の商品を創ろう」です。当社が培ってきたコア・テクノロジーを応用することに加え、世界No.1の製品創りという共通目的をもつ国内外の会社および個人と“WIN－WIN”の関係を築くことにより、世界No.1の製品開発体制を構築して、真のグローバル・カンパニーとなるべく努力しています。

## 目次

01	財務ハイライト
02	プロフィール
03	株主のみなさまへ
05	Always Seeking Better Ways
05	半導体製造装置事業
07	計測機器事業
09	セールス
11	営業概況
11	半導体製造装置事業
17	計測機器事業
21	研究開発活動と知的財産
23	コーポレートガバナンス
25	環境への取り組み
26	役員紹介
27	財務セクション
57	ネットワーク
58	株主情報

2006年度は、売上高と当期純利益は前年比大きく伸  
長し過去最高となりましたが、営業利益は前年比微増  
に留まりました。今後の課題として、引き続き業績の  
推進に努めてまいります。

2006年度は、半導体メーカーの設備投資は総じて  
旺盛で、需要は堅調に推移しました。また、計測機器の  
事業環境も、特に海外向けが大きく伸張し、良好な一年  
であったといえます。これらの結果、2006年度の受  
注高は前年度比5.9%増の1,054億60百万円、売上高  
は前年度比8.1%増の1,003億22百万円、営業利益は  
前年度比0.7%増の140億86百万円、当期純利益は約  
2.8倍の87億41百万円となりました。このうち、売上  
高と当期純利益は過去最高を記録しました。

セグメントごとに見ますと、半導体製造装置事業の受  
注高は前年度比5.9%増の824億65百万円、売上高は  
前年度比8.7%増の780億91百万円とどちらも過去最  
高を記録しました。しかしながら、営業利益に関しまし  
ては前年度比1.6%減の88億30百万円となりました。  
これは、ウェーハブローイングマシンとウェーハダイシン  
グマシンの新機種に関して一時的な費用増が生じたこと  
と、ポリッシュ・グラインダが一部地域で採算が低下した  
ことに起因しています。一方、計測機器事業では、受注高  
が前年度比6.0%増の229億94百万円、売上高が前年  
度比5.8%増の222億30百万円、営業利益も前年度比  
4.7%増の52億56百万円となり、受注高、売上高、営  
業利益とも、4年度連続過去最高を記録しました。

業績の詳細は後述の「営業概況」と「財務セクション」  
をご参照いただければと思います。

私から、この場をお借りしまして、それぞれの事業にお  
ける現状の課題と今後の戦略に関してご説明いたします。

#### 新規参入製品を事業の大きな柱に育成

昨年のアニュアルレポートでもご説明しましたが、現  
在、当社の半導体製造装置事業では、2000年度以降に  
市場投入した新規参入製品群を早期に市場に根付かせ、

事業の大きな柱に育てていくことが急務です。この新規  
参入製品とは、ウェーハ外観検査装置、ポリッシュ・グ  
ラインダ、CMPの3つの製品を指します。

この新規参入製品に関する2006年度の状況をご説  
明しますと、ウェーハ外観検査装置は、上半期の受注が  
低迷したこと、ポリッシュ・グラインダは好調であった  
前年度の反動もあり、市況が低迷したことなどが影響し、  
半導体製造装置事業の売上高に占める新規参入製品の売  
上高比率は2005年度の29%から21%に減少しまし  
た。2007年度以降これらの製品を伸ばし、売上高比  
率の回復を図ってまいります。

現状では、ポリッシュ・グラインダの市況は回復して  
おり、また、ウェーハ外観検査装置の開発も整い、受注  
も順調に推移しています。CMPに関しては、今後当社装  
置の優位性を最も生かせる分野に注力し、受注に結び付  
けていきたいと考えています。2007年度、これらの製  
品の半導体製造装置事業の売上に占める割合は約28%  
まで回復し、利益への貢献も拡大すると予想しています。

#### 技術資産を共通プラットフォームに集約

当社の半導体製造装置はこれまで製品ごとのグルー  
プ・リーダー制を敷き、縦割り組織で事業を展開してきまし  
た。これは、各製品の立ち上げ期には非常に有効に機能  
してきましたが、次の展開が必要な現状では若干の手直  
しが必要であると感じています。つまり、制御系、ソフト  
ウェアやインターフェイスなどの共通技術をより効率的  
に開発していく必要がありますし、市場からも統一され  
た共通技術への高いニーズがあります。そこで、2007年  
2月にこれら共通プラットフォーム開発を担当するテクノロ  
ジー・デベロップメント・グループ(TDG)を設立しました。

TDGの効果は2007年度末までには大きな成果となっ



代表取締役社長CEO兼COO 鈴木 貞勝

て現れてくるはずで、機器間のインターフェイスの向上や、開発のスピードアップを期待しています。これにより、当社製品の品質や保守性能が大きく向上しますし、同時にTDGがエンジニア達にとって、さまざまな技術を学べる教育機関になることも期待しています。

#### 利益率の向上と海外での拡販が計測事業成長の鍵

計測機器事業は過去4年連続で、受注高、売上高、営業利益で過去最高を記録しており、非常に堅調な事業です。自動車関連産業が当社の主たる顧客であり、非常に安定した成長が見込まれる市場です。今後は、成長を継続させるとともに利益率をさらに改善していくことが大きな課題で、このための設備投資は積極的に行っていく計画です。

拡販については、今後は海外、特にアジアや欧州の自動車産業への拡販を積極的に図っていく計画です。これらの地域のメーカーへの機器納入のために、拠点や人員の拡充をしており、ドイツのカール ツァイス社と提携して販売の増加に努めています。日本の自動車メーカーの現地生産や現地メーカーとの共同生産にあわせて、当社の技術を積極的にアピールしていく計画です。

#### 株主還元の一環としての配当性向の引き上げ

当社は、成長分野において、最先端技術を駆使した世界No.1商品を提供することにより、企業価値を高め、株主の皆様への継続的な利益還元を行うことを経営の最重要課題と考えています。剰余金の配当につきましては、連結業績や財政状況及び中長期的な事業拡大のための投資等を考慮して決定いたします。

具体的には、2006年度までは、連結当期純利益に対する配当性向20%を目途に実施してまいりましたが、今後は、株主様への還元をより重視する観点から、配当性向を引上げることとし、2007年度からは配当性向の目途を30%とする方針です。

#### 世界トップ10に入る半導体製造装置メーカーを目指して

当社は、2006年4月に、創立60周年となる2009年3月期までの中期計画「AA60 (ACCRETECH Action 60)」をスタートさせました。2009年3月期の目標数字は、半導体製造装置事業の売上高1,000億円、計測機器事業の売上高250億円、全体の営業利益率25%です。チャレンジングな目標ですが、戦略、戦術を明確にして目標に向かって挑戦してまいります。

現在、当社は半導体製造装置業界では、世界で15位のポジションにいます。当社の特徴であるフットワークの良さや高いチャレンジ精神を生かして、トップ10を目指してまいります。この目標を達成するうえで、「モノづくりの原点」とも言える当社の計測機器事業の存在は非常に有効だと考えています。

さらに、重要なことは製造業の基本に戻ることです。製造業の使命は、良い物を開発し、安く作る、それを適正価格で多く売るということです。市場での勝敗はこの各プロセスにおける従業員のモチベーションの高さにかかっています。今後とも、社員のモチベーションを高く保つと同時に、新製品の開発と製品を作る工場の拡充には積極的に投資を続けていく計画です。

株主並びに投資家の皆様には、今後とも倍旧のご指導とご鞭撻を賜りますよう、この場をお借りしまして、お願い申し上げます。

代表取締役社長CEO兼COO

鈴木貞勝

半導体社は現在5つの製品を開発・製造しています。これらの製品の中には共通の基本技術が多くあり、これまで各グループが並行して行っていたこれらの基本技術開発をTDGが行うことにより、各グループは製品能力に一層特化した開発に注力できることと、合わせて開発投資・期間の圧縮と製品品質の向上が可能になります。

テクノロジー・デベロップメント・グループ (TDG) とはどのような組織でしょうか？

半導体社では現在5つの製品グループがあります。製品ごとにグループリーダーがおり、製品ごとに売上・利益など全て統括しています。この体制を10数年続けることで、製品力の強化を図ってきました。

しかし、反面では非効率な面もでてきました。例えば、「技術の共有化」です。

これらの製品ではその開発時に、基礎技術の上に要素技術や製品独自のプロセス技術等を付加していきます。この基礎技術と要素技術は製品間で共有できるものが多くあります。高精度位置決めや搬送技術そして画像処理と言った技術がこれに相当します。TDGがこれらの共通技術をより安定した技術として開発し提供することで、各グループの製品開発の底上げを行うわけです。

TDG設立の目的は？

このグループには基本的に2つの目的があります。第一は製品開発の合理化です。開発コストを下げるために共通の技術を一箇所で

開発、管理することで、各グループは開発リードタイムを大きく短縮できるはずで

第二は人材の育成です。TDGは非常に人的弾力性の高い組織です。現在は各グループのマネージャクラスを中心に集結し、基礎技術や要素技術に関しての開発基盤を作っていますが、今後は、開発テーマに合わせた各種プロジェクトが逐次発足し、各グループからTDGに参集したエンジニア達がそれに参加していきます。プロジェクトが終われば、またエンジニアはそれぞれ製品グループの開発に戻って行きます。製品の枠を超えたエンジニアが、同じプロジェクトを通して、多くのことを学ぶことができます。

TDGの役割と課題とはどのようなものでしょうか？

各製品グループが開発目標を加速し、達成することができるよう支援することが私たちTDGの役割です。現在は主に次の3つの課題に取り組んでいます。戦略製品の新しい開発支援を行うこと、既存製品の持つ技術課題を短期に解決し競争力を高めること、今後の開発のための標準化を推進することです。



半導体事業の全ての製品を業界トップに押し上げる。これがTDGの抱く夢です。

株式会社東京精密  
半導体社 執行役員常務  
テクノロジー開発グループ リーダー  
二瓶 誠

各製品開発に何が必要かということ各製品のマーケティングの方々などから教えていただきながら進めていますが、今期の下期ぐらいから具体的に製品開発にその成果が表れてくるはずですよ。

TDGが描く「夢」とはどのようなものでしょうか？

それは5つの製品グループが常に世界NO.1の製品を出し続けることです。そしてそれらが時代を画するような製品であれば嬉しいですね。

エンジニアには皆それぞれさまざまなアイデアがあると思います。時として資金の問題や組織内のマインドがそれらのアイデアの具現化にブレーキをかけてしまうことがあります。これは私個人の夢かもしれませんが、ブレーキでなく、一緒にアクセルを踏み込むお手伝いできれば楽しいですね。

東京精密（ACCRETECH）はもともと計測事業を営む会社でした。これが示していることは、私どもには半世紀以上にわたって培われた計測に関する知識やノウハウが蓄積されているということです。これらの経験をベースにお客様に常に「より良い方法」を提案し続けます。

#### 計測事業における目標は？

世界No.1の計測機器をお客様に提供し続けることです。それは、精度、機能、操作性、品質、コストパフォーマンスの5つのどれをとっても世界No.1でなくてはならない、さらに、このNo.1は他社と比較して大きく抜きん出たNo.1でなくてはなりません。

#### お客さまにとって、「より良い方法」とは？

私たちの仕事はおお客様のご意向を汲み取って、それに合わせた開発をすることです。しかし、私たちがお客様に提案するものはお客様の期待を良い意味で裏切るものでなくてはなりません。そのような開発には、開発者が既存の技術の延長ではなく、全く新しい発想でチャレンジしなければ達成できないような高い目標を設定することを心がけています。そうすればお客様は非常に驚かれ、同時に喜ばれます。そして市場で独占的シェアを獲得できる製品が誕生するはずで。

#### 具体的な例はありますか？

例えば、表面粗さ・輪郭形状測定機です。この計測機器では低振動と測定スピードの両立が最大の課題でした。仮に、私たちがこれまでの「倍」のスピードを目標に開発しようとする。この場合、ほとんどの技術者はこれまでの技

術の延長でその目標の達成を考えるとしよう。結果としては、これまでの1.5倍、うまく行けば目標通りの2倍のスピードのものは出来るかもしれませんが、これではお客様に驚きを与えることはできません。そこで、一桁違う高い設定をする。私たちは「10倍」の速さを目標に設定しました。すると開発者は根本から発想そのものを変えなくてはなりません。見つかった答えは、ギアやモーターなどの振動源となる回転機構を排除した「リニアモーター方式」です。これにより目標の従来比10倍の測定速度を実現できました。この“一桁違う革新性”こそが「ACCRETECHらしさ」ではないでしょうか。

#### 操作性の向上にも取り組んでいますか？

好例は、三次元座標測定機です。かつて、この計測機器は高機能で測定範囲の自由度が高いことから非常にプロフェッショナルなオペレータを要求するものでした。操作を覚えて、自由に使いこなせるようになるには半年かかるとさえ言われたものです。そこで私たちはAI（人工知能）機能を取り入れました。お客様の測定機の動かし方から、何を計りたいのかをAIが推測し、自動的に計算して結果を出してくれるというものです。この機能は私たちが常に求めているお客様への「より良い方法」のご提供であると確信しています。この機能は後に他の製品群にも応用され、当社の要素技術のひとつに成長しました。



「測れないものは作れない」  
これが計測事業の根底を形成しています。

株式会社東京精密  
取締役 計測社 執行役員常務 汎用計測グループリーダー  
吉田 均



真円度・円筒形状測定機「ロンコム 76A」

「より良い方法」はWIN-WINの関係にも適応されるわけでしょうか？

当然そうです。最適な例はカール ツァイス社との提携でしょう。同社はハイエンドクラスの三次元座標測定機分野では世界市場のリーダーです。当社は表面粗さ・輪郭形状測定機、真円度・円筒形状測定機の2分野で国内トップシェアを持っていました。この2社がタッグを組めば、両社の得意分野が相互補完することができます。各製品の技術の核となるものを双方で共有し、かつての競合が現在では別会社とは思えないほど、良好な関係へと進展しています。

今後の課題はどのようなものでしょうか？

国内で当社はトップのシェアを誇っていますが、グローバルな世界市場で見るとまだまだです。今後は、海外、特に欧州の自動車会社に拡販したいと考えています。現在、自動車メーカーの品質管理方法が変わってきています。高品質に対する取り組みが一層強化され、これまでの抜き取り検査ではなく、全数検査に移行しています。当然、ラインでの高速・全自動測定が必要となります。また、省エネ(低燃費)に向けての各種部品の精度アップが進み、測定機に要求される精度も更に上がっています。これらは、当社が得意としている分野です。当社の「一桁以上」の技術革新を推し進め、世界No.1の製品でこれらの市場にチャレンジしていきます。

「より良い方法を常に提案する」ことが営業活動そのものといっても過言ではありません。良い営業とは常に相手の立場に立った提案をし続けることです。これこそが、お互いにメリットのあるWIN-WINの関係を築きあげていく鍵になります。

東京精密（ACCRETECH）の営業の仕事は以前とくらべ変わりましたでしょうか？

私は、入社以来ずっと営業の仕事をしているのですが、まず会社の売上が5倍になりました。実際のモノづくりを担う技術や製造と同様に、営業の役割もますます重要となっていますので、やりがいがあります。しかし、同時に扱う製品が増えました。現在八王子工場では5つの製品を開発・製造しています。当然、これらの製品はだんだん高度になり、難しくなっています。これらに関しての詳しい知識をもっていないといけません。また、当社が販売していませんが、一連の半導体製造プロセスのことは知っていないといけません。勉強しなくてはならないことが非常に多岐にわたるようになりましたね。

東京精密（ACCRETECH）の営業の特徴と言えるものはありますか？

敢えてあげるとすれば、一人に任される仕事の範囲が大きいということでしょうか。会社によって営業のスタイルは異なると思います。当社は、特に歴史の長い既存製品についてはすべて一人でやります。プレゼンテーションはもちろん、技術に関する質問も営業が回答

します。営業は東京精密（ACCRETECH）を代表してお客様に接しているわけです。これにより、お客様との窓口が一本化されますし、信頼していただける結果になります。

営業活動をされる上で何を一番心がけていらっしゃいますか？

営業に限ったことではないかもしれませんが、常に相手の立場に立って物事を考えることでしょうか。「私がお客様だったら」と。すると、何をどう話せば納得していただけるかおのずと見えてきます。

また、常にストーリーを頭の中に描いていることも大事です。私たちのプレゼンテーションからお客様に納品するまでのストーリーです。逆に、お客様側から見たストーリーも同様に描きます。両方のストーリーを組み合わせると、いつ、何を、誰に、いくらで販売するということが分かってきます。

さらに付け加えると、営業で重要なのはお客様との人間関係です。お客様の窓口の担当者のもとより、製造、生産技術、購買などの方々からもよくお話を伺います。さまざまな部署の方々からお話を伺うと、その会社の設備投資や予算などの状況が見えてきます。



営業の極意は「常にお客様の立場に立って考える」ことだと思います。

株式会社東京精密  
取締役 半導体社 執行役員常務  
木村 龍一



ウェーハプロービングマシン「UF3000EX」

人間関係を構築する中で、お客様からの質問やクレームにスピーディーに対応することも重要で、誠実さを示し、信頼関係を築いていきます。

営業に必要な資質はあるのでしょうか？

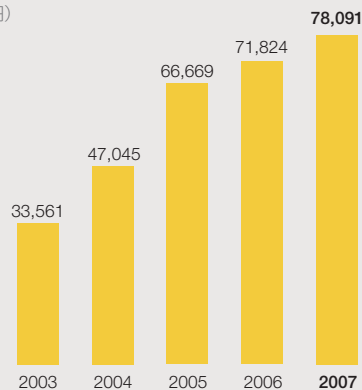
いろいろありますが、特にいえば「あきらめない」ということでしょうか。とにかく、忍耐強くお客様にアプローチすることです。そうすると、いつかチャンスはいただけるものです。そして、いただいたチャンスは絶対に逃さないことです。もちろん、めったにチャンスをいただけないこともあります。そういう時は、お客様に対しても社内においてもすべきことをした上であきらめずに、次の手を出し続け、なぜ受注いただけないかを解明します。チャンスまで長い時間を要することもあります。必要なことを継続してアプローチしていれば、ひよんなきっかけからとんとん拍子で運んで商談が成立することもあります。とにかくあきらめないことが肝要でしょうね。

## 半導体製造装置事業

### 売上高

(3月31日に終了した事業年度)

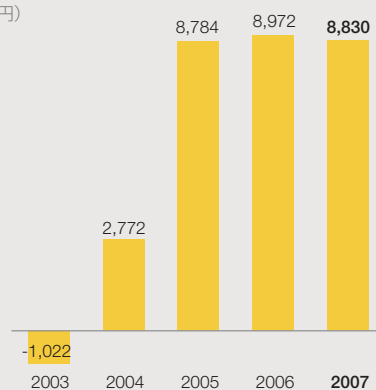
(百万円)



### 営業利益

(3月31日に終了した事業年度)

(百万円)



### 2007年3月期（2006年度）を振り返って

半導体製造装置事業は、上半期は極めて好調裡に推移しました。期初にあたる4月や5月の売上は、特に高水準であり、4月は単月での当社の既往最高を記録しました。その後、第3四半期は上半期の反動もあり、上期に好調であった液晶ドライバや携帯電話関連の各ICデバイスがやや調整局面となりました。第4四半期に入り、アジア諸国での投資拡大などに支えられ、回復傾向が顕著になりました。

半導体メーカーの設備投資は、一般的に、薄型テレビ・ゲーム機器などのデジタル・コンシューマー機器の需要増などにより、メモリデバイスを中心に活発に推移しました。当社は、お客様のニーズに応えるきめ細かい営業を展開しました結果、今年度の受注高は、824億65百万円（前年度比5.9%増）、売上高は、780億91百万円（同8.7%増）となり、ともに既往ピークを更新しました。営業利益は、新機種の投入で一時的に費用が増加したことなどから、88億30百万円（同1.6%減）となりました。

2006年度は、地域別に見ますと、国内が前年度比16.9%増と大幅に伸びました。海外は全体では、前年度比3.7%の増加で、欧米や東南アジア向けが大きく伸長しました。昨今、半導

体メーカーは、生産拠点を東南アジア・台湾・中国を中心としたアジア諸国に移しており、当社も今後一層の成長が見込まれる同地域での拡販に注力してまいります。

### ウェーハプロービングマシン（プローバ）

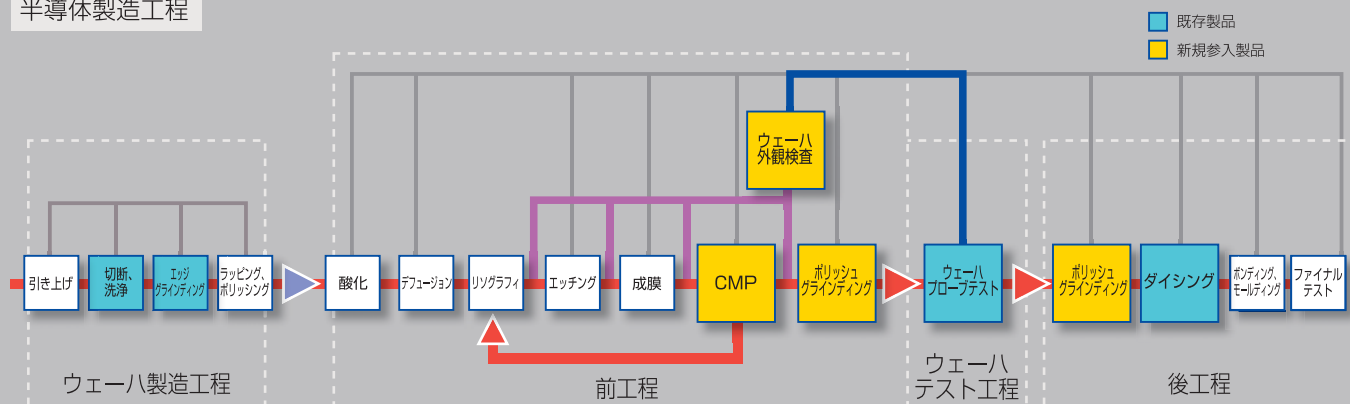
DRAMやフラッシュ・メモリなどのメモリデバイス需要の好調とウェーハでのフルテストの必要性の高まりなどを背景に、需要は堅調で、売上高は前期比大きく伸びました。

300mm対応の第三世代機である「UF3000」は、システムLSIなどの多品種少量生産から、メモリなどの大量生産まで、様々なニーズをカバーするフルオートタイプの超高性能プロービングマシンとして、お客様から高い支持を得て、売上を伸ばしています。

VLSIリサーチ社の顧客満足度調査のハンドリング部門において、12年連続で「10BEST賞」を受賞し、今年度は第3位（プローバメーカー内第1位）を受賞しました。今後もマーケット志向の製品開発によりお客様によりご満足いただけるように営業活動を進めてまいります。

さらに、2006年度の終わりには、従来の常識や概念を超えた設計思想に基づく、高精度かつ高スループットの「UF3000EX」を販売開

## 半導体製造工程



プローバは、ウェーハ上に形成された半導体チップの電気性能テストを行う装置であり、半導体の品質管理において欠かせない装置です



ウェーハプロービングマシン「UF3000EX」

始しました。「UF3000EX」は、全く新しいコンセプトに基づいて開発された戦略的新製品であり、プローバの為に新開発した専用駆動ユニットを搭載しています。「Fast, Quiet& Clean」をコンセプトにしたこれまでの常識を覆す次世代の高品質・高速プロービングを可能にしました。視認性と操作性も飛躍的に向上した同製品は、2007年度以降の業績拡大に寄与するものと期待しています。

また、ロジックやLCDなどのデバイス向けに、200mm対応機の「UF200」シリーズにも根強い需要があります。最新モデルである「UF2000」は、200mmウェーハ対応プローバのデファクト製品として、受注・売上とも堅調に推移しています。

当社は、ウェーハプロービングマシンのNo.1プレーヤーとして、2006年度は世界的にシェアをさらに拡大し、前年度を大幅に上回る過去最高の売上高を達成しました。

#### ウェーハダイシングマシン（ダイサ）

2006年4月には、世界最高速である毎分8万回転のスピンドルを備え、高い生産性を有する300mm対応の新製品「A-WD-300TX」を市場投入しました。上半期に市場への浸透に注力した結果、下半期から着実に受注が増加しており、今後の一層の売上拡大が期待されます。

VLSIリサーチ社の顧客満足度調査のアセンブリ部門において、6年連続で「10BEST賞」を受賞し、今年度は第3位（ダイサメーカー内第1位）を受賞しました。今後もお客様のニーズにあった製品開発に注力してまいります。

また、2004年度より販売開始した、ブレードを使わない新型レーザーダイシング装置

「MAHOHDICING MACHINE」は、ユーザーから完全ドライプロセス、ダストフリーをはじめとする従来のブレードダイサにはない特性と高い生産性を評価され、2006年度売上は、MEMS（微小電子機械システム）向けやイメージセンサー向けに前年度比倍増となりました。また、ブレードダイサ比3～5倍という高スループットの利点が生かせる薄物ウェーハ向けの需要も当期より顕著になり、リピートオーダーも増加しており、今後のさらなる拡販が期待されます。

#### ウェーハ外観検査装置

「WIN-WIN50」シリーズの強みである、高い欠陥検出率などが高く評価され、既存ユーザーからリピートオーダーを頂くとともに、新規ユーザーも増えています。当期は、上半期はやや売上が低迷しましたが、下半期の受注・売上は上半期比倍増となりました。2007年初めより、幅広いアプリケーションと量産性に優れた新製品の市場投入を行い、お客様より高い評価を得ております。また、製品投入時のソフトウェア開発費の減価償却が2007年度初頭で終了するなど収益環境も好転しており、同事業による利益への貢献も高まることを見込まれます。良好な市況見込みのもと、2007年度はさらなる業績拡大を目指します。

#### ポリッシュ・グラインダ

ウェーハの薄片化とダメージ除去を1台で実現している当社独自の製品で、ウェーハ薄片化市場におけるデファクトスタンダードとなっています。

上半期は、前期に需要が急増した反動もあり、

レーザーダイシングマシンは、ブレード(刃)を使用せず、レーザーを用いてウェーハを高速切断します。水を使用せず、完全ドライプロセスを実現します



レーザーダイシングマシン「ML300」MAHOHDICING MACHINE

ウェーハ外観検査装置は、回路のパターンが転写されたウェーハ表面の異物やパターン欠陥などを検出する装置で、半導体の歩留まり向上に貢献します



ウェーハ外観検査装置「WIN-WIN 50」

低調な市況でしたが、下半期に入り、アジア全体への市場の拡がりもあり、需要は急回復しています。「PG300RM」を中心とした薄片化市場は、これまで主に韓国地域が需要を牽引していましたが、半導体市場全体の薄化レベルが進展し、台湾・中国・東南アジアにも販路が広がっております。この市場は、2006年度に新たに競合の参入があり、競争が激しくなっています。しかしながら、当社のポリッシュ・グラインダは、これまでNand型フラッシュメモリの成長を支えてきた先端性にますます磨きをかけており、今後、薄片化が進展する中で、当社技術の競合比優位性はますます高まり、当社の薄片化市場におけるリーダーとしての立場はさらに強まると考えています。

#### CMP装置

当社「ChaMP」シリーズの長所である低压高速研磨がお客様に浸透しつつあります。銅配線プロセスをはじめとする当社の優位性が生かせる分野に特化してさらなる拡販を目指すとともに、原価低減にも注力しており、今後の採算向上につなげる見込みです。

#### 2008年3月期（2007年度）の見通し

今後の半導体市場は、携帯電話および薄型テレビなどのデジタル・コンシューマー機器の需要増に加え、新OS対応パソコンの普及や車載デバイスの伸長などにより、引続き高い成長が見込まれ、半導体メーカーやファウンドリーによる堅調な設備投資が期待されます。

このような状況下、当社は、2007年度の半導体製造装置市場について、既存製品および新

規参入製品とも市場環境は明るさを維持していると考えています。

既存製品のウェーハブロービングマシンは、検査装置の重要度の高まりにより、市場が拡大するなかで、新製品「UF3000EX」の寄与もあり、マーケットシェアを伸長させる予定です。受注・売上も回復傾向にあり、2007年度においても、非常に好調であった前年度と同程度の売上水準を予想しています。また、ウェーハダイシングマシンは、新製品「A-WD-300TX」の浸透による売上増とレーザダイシング装置「MAHOHDICING MACHINE」の拡販を見込んでいます。

新規参入製品についても、回復基調にあるポリッシュ・グラインダと、新製品の市場投入が寄与するウェーハ外観検査装置は、当期に比べて大幅に売上が増加すると予想しています。CMP装置も、顧客開拓と原価低減を推進し、採算性を向上させてまいります。

ポリッシュ・グラインダは、ウェーハの裏面を研削すると同時に、ダメージ除去を行います。これらの基本機能に加えて、周辺プロセスに対応したさまざまなアプリケーションを提供しています



ポリッシュ・グラインダ「PG300RM」

CMP装置は、ウェーハ表面の凹凸を平坦化する装置で、半導体デバイスの多層化や、配線材料の多様化にともない、用途が拡大しています



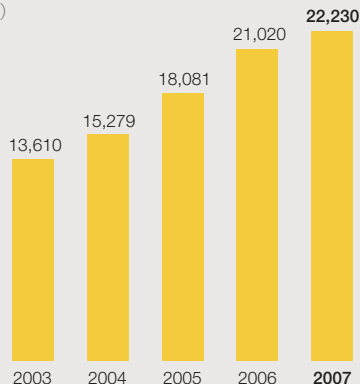
CMP装置「ChaMP」

## 計測機器事業

### 売上高

(3月31日に終了した事業年度)

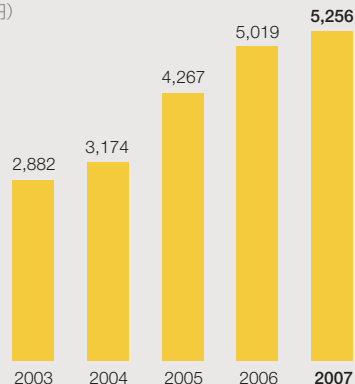
(百万円)



### 営業利益

(3月31日に終了した事業年度)

(百万円)



### 2007年3月期（2006年度）を振り返って

計測機器事業につきましては、国内では、一部に設備投資の繰延べが見られましたが、海外向けは、自動車や工作機械業界など需要が好調でありました。当社はユーザーニーズを確実に受注に取込む営業努力により、受注・売上とも順調に拡大しました。2006年度の受注高は229億94百万円(前年度比6.0%増)、売上高は222億30百万円(同5.8%増)となり、ともに過去最高となりました。受注高・売上高とも、2003年度以降、4年連続既往ピークを更新しています。生産面でもコストダウンに注力した結果、2006年度の営業利益は、52億56百万円(同4.7%増)となりました。営業利益も4年連続過去最高を更新中です。

計測機器のメインユーザーである自動車関連業界では、環境性能や安全性能へのさらに進んだ要求から計測機器への需要は拡大しています。例えば、最適な燃焼効率を得るための部品計測や、車内の快適性のための低振動・低騒音の実現には、当社の高性能な計測機器を活用した高精度計測が必要です。汎用計測器による部品計測が、抜き取り検査から製造ラインサイドにおける全数検査に代わる例もあり、今後の市場の成長が期待されます。

### 地域別の状況

地域別に見ますと、国内向け売上高は、前期比0.5%増と微増にとどまりましたが、海外向け売上高は、前期比37.1%増と非常に好調で、特に東アジア向けの売上が拡大しました。

カール ツァイス(ドイツ)社との全面提携により、当社の汎用計測機器については、欧米地域ではカール ツァイス社による販売活動を行っております。10余年にわたる非常に良好な提携関係をさらに強化し、同地域での拡販を目指しております。また、当社の販売担当地域である日本を中心としたアジア地域では、拠点の拡充を含めさらなる販売網の整備をおこなっております。

### 製品別の状況

#### 汎用計測機器

##### 三次元座標測定機

カール ツァイス社の解析・制御技術と当社の高剛性設計技術を融合した「ザイザックスSVA」シリーズが、お客様のニーズに合った製品として好調ですし、スキャニング高精度保証の「ザイザックスSVA fusion」も順調です。前期に市場投入したカール ツァイス社の新製品「ゲージMAX」も、お客様の製造ラインサイドで使用さ

三次元座標測定機は、測定物における対象(間)の寸法(または距離)を測定する装置です。カールツァイス社の「CONTURA G2 RDS」は幅広い測定対象と容易な操作性に優れています



三次元座標測定機「CONTURA G2 RDS」

表面粗さ・輪郭形状測定機は表面粗さをナノメートル単位で計測することができます。「サーフコム2000DX」シリーズは、リニアモーター駆動により、世界で最高速、低振動を実現しました



表面粗さ・輪郭形状測定機「サーフコム2000DX」

れる三次元座標測定機として、着実に売上が伸びています。

非接触による毎秒25万点超高速・高密度の測定が可能なラインレーザーセンサーを搭載した非接触CNC三次元座標測定機も業績への一層の貢献が見込まれます。

#### 表面粗さ・輪郭形状測定機

リニアモータ採用で世界最高精度と低振動を実現した「サーフコム」シリーズも、「サーフコム1500/2000DX」や「コンターレコード1700DX」などの売上が拡大しています。表面粗さ・輪郭計上測定機では、世界で初めてリニアモータ駆動部を採用し、非接触駆動・低振動・高速駆動を世界最高レベルで実現しています。また、新開発の「広範囲粗さ輪郭統合検出器」を搭載したモデルでは、これまで不可避であった粗さ計と輪郭計上の評価解析において、検出器の交換が不要となり、測定効率が向上しました。

#### 真円度・円筒形状測定機

高精度で高評価を得ている「ロンコム」シリーズでは、「ロンコム54DX/44DX」や「ロンコム72A」などが順調に伸長しています。また、「ロンコム65A」は、世界No.1を追求し、業界初の高精度エアベアリングや経年変化の少ないはんれい岩を採用するなど最高クラスの高精度を長期にわたり保証します。

#### 自動計測機器

国内における自動車産業の設備投資の調整を受けて、自動車の部品生産ライン等で使用される「パルコム」シリーズが伸び悩み、売上高は

前年度を下回りましたが、2007年度は、市況は回復の見込みです。開発・販売を担当する子会社の東精エンジニアリングでは、土浦本社や名古屋事業所で各工場を増築するなど今年度の拡販に備えております。

#### 2008年3月期（2007年度）の見通し

計測機器事業につきましては、国内は一部繰延べされていた自動車関連の設備投資が活発化してくると予想されますし、航空機業界や建設機械業界も設備投資に積極的です。海外も引続き自動車関連や工作機械をはじめとする各ユーザーから力強い需要が見込まれます。安定的な成長が見込まれる市場において、高い成長を目指すために、国内での磐石な基盤を整えると共に、海外市場への積極的な拡販を進めて参ります。

真円度測定機は、円筒形状の真円度、同心度、円筒度などを測定する装置です。「ロンコム65A」は世界最高の回転精度を誇り、世界最高のスループットを実現しました



真円度・円筒形状測定機「ロンコム65A」

マシンコントロールゲージは、加工中あるいは加工前後に測定したデータをもとに加工機を制御する装置で、加工不良防止や加工精度と生産性向上のために不可欠なシステムです

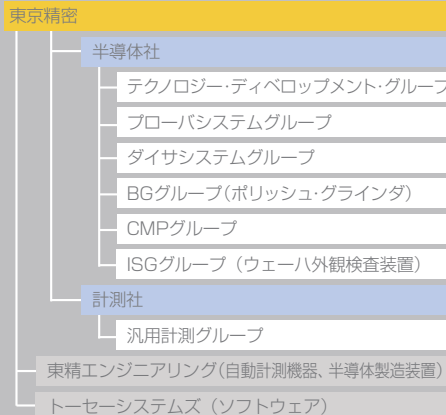


自動測定機器とマシンコントロールゲージ「パルコムV10A、V11」(管制部)と各種「パルコム」測定ヘッド

## 研究開発活動

### 「製品開発の原則」

1. 世界No.1の製品を創る。  
 マーケットシェアNo.1の商品は  
 (1) 好況時の利益の極大化が図れる。  
 (2) 不況時の損失の極小化が図れる。
2. 研究開発投資は自己資金で。
3. 開発は技術参入障壁が高く、マーケットが大きくニーズも高い分野を狙う。
4. 相応しいパートナーを見つけ、開発コストをシェアするとともに開発の成果を共有する。



### 研究開発方針—「製品開発の原則」

「製品開発の原則」は、当社にとって単なる研究開発のための方針ではなく、当社の企業戦略といっても過言ではありません。当社が発展し続けるために最も重要なことは、強い製品開発体制と適正な製品開発基準を持つことです。当社は、「製品開発の原則」を経営の大原則とし、これに沿って技術開発を継続的に行っています。

### 研究開発体制

#### グループリーダー制

当社は、開発体制として、1988年より技術開発グループを製品群別に分け、技術者を各グループのヘッドとするグループリーダー制を採用しています。グループリーダーは、製品開発のみならず、担当する製品群の業績全般についての責任を持ち、事業計画作成、設備投資および人材の採用など大きな権限を与えられています。2002年4月、当社の執行役員制導入にともない、グループリーダーは執行役員に選任されました。これにより、グループリーダー制が備えている、開発計画などのスピーディーな意思決定や市場動向への迅速・柔軟な対応という長所が一層強化されました。

2007年2月より、各製品に共通の要素技術の開発を担当する新グループTDG(テクノロジー・ディベロップメント・グループ)を設けました。これにより新製品開発の一層の加速と、エンジニアの教育機関としてスキルアップの機会の提供を実現してまいります。

#### グループ開発体制

当社の子会社である東精エンジニアリングは、ウェーハ製造関連の半導体製造装置および自動計測機器の開発・製造・販売に特化し、ニッチマーケットに強い会社で、東京精密の計測社と一体となり、お客様のニーズに的確に対応し、最先端技術の世界No.1の製品を開発していくために連帯を一層強化し、迅速かつ機動的な事業運営を行っています。

2007年4月1日より、ウェーハ外観検査装置の開発・製造をする子会社アクレーテック・マイクロテクノロジーを合併しました。これにより半導体社内にISGグループを新設しました。

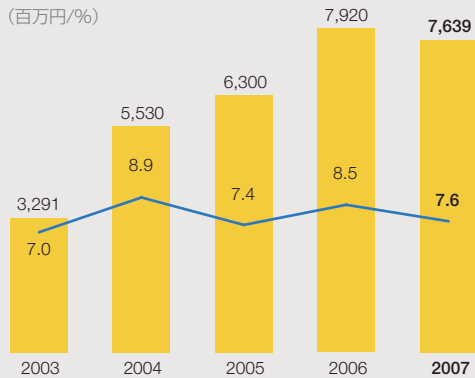
さらに、子会社であるトーシーシステムズは、半導体社と計測社の製品に関連したソフトウェアの開発を行っています。各グループ会社は、東京精密とは相互の強みを活かした補完関係にあり、今後も研究開発活動を協力して行っていきます。

# 知的財産

## 売上高に占める研究開発費の比率

(3月31日に終了した事業年度)

(百万円/%)



## 特許保有件数および出願件数

(2007年3月31日現在)

	特許権利 保有件数	2007年度の 特許出願件数
国内特許	312	141
外国特許	320	77

■ 研究開発費  
■ 売上高比率

## 知的財産

### 知的財産重視の方針

東京精密は、技術参入障壁の高い分野において圧倒的な競争力を持つ製品を生産するため、最先端分野の研究開発を継続的に実施しています。こうして生み出された技術情報を中心とする知的財産を、今後の事業の付加価値の源泉と考え、特許取得や知的データベースの構築などを計画的に行っています。

### 知的財産戦略

当社では、製品開発構想が生まれた時から製品出荷後の顧客対応に至るまでの各段階で、知財担当部署と技術部門が一体となって、他社の特許や技術動向の調査・評価を行います。さらに市場ニーズを踏まえて、競合企業よりも優位に立てる先端技術に関する特許の出願に力を入れるとともに、事業のグローバル化にともない、海外でも積極的な権利取得に取り組んでいます。

また、特許の価値を重視し、保有する特許権利について、研究開発の進捗状況や製品市場における競合他社との位置関係なども考慮した上で、常に資産価値評価を行っています。価値の低い権利は破棄するなど、保有する特許の入れ

替えをし、貴重な知的財産のポートフォリオを形成しており、特許維持コストの効率化を図っています。

### 2007年3月期の状況

2000年以降に市場へ投入したポリッシュ・グラインダやウェーハ外観検査装置、CMP装置などの新規参入製品群と、受注が好調な既存製品群のプローバ装置やダイシング装置、自動計測機器などの競争力を高める特許出願を集中的に行いました。

現在における当社の半導体製造装置関連および計測機器関連の特許出願比率は約8：2です。

# コーポレートガバナンス

## 基本的な考え方

当社は、経済のグローバル化が進み、企業の経営環境が目覚ましい変化を遂げる中、企業が持続的な成長を実現し、企業価値を高めていくためには、国際化と株主重視の経営に適合したコーポレートガバナンスの充実が不可欠と認識しています。

当社は、株主の権利と平等な扱いに留意するとともに、他のステークホルダーについても、権利を尊重し、円滑な関係の構築に努めています。株主をはじめとするすべてのステークホルダーの権利・利益を守るためには、適切な情報開示により透明性を確保することと、取締役会と監査役会が期待される機能を発揮することが重要であると考えています。

## コーポレートガバナンス体制

### 1. 取締役・取締役会

当社の取締役会は、出身企業が多岐にわたる9名の取締役で構成されたハイブリッドな組織となっています。取締役会は議長を社長とし、毎月1回開催され、半期ごとの業務計画など重要事項の決定および取締役の業務執行状況の監督などを行っています。当社は社外取締役を選任していませんが、これは社外のチェックという観点において、社外監査役による監査が有効であると考えているためです。

さらに当社は、取締役会議長の諮問機関として、諮問委員会を設置しています。諮問委員会は監査役で構成されており、取締役の報酬や経営の諸テーマについて意見具申を行っています。

### 2. 監査役・監査役会

当社は、監査役の役割を活用したコーポレートガバナンスが有効と考え、監査役設置会社形態を採用しています。当社の監査役は、経営経験豊富な方々や監査・会計の専門家などで構成されており、その監査機能は高く、経営者の業務執行が適正かつ効率的に行われていることを監督しています。また、監査役機能の強化の観点より、2006年6月より5名に増員し、うち3名が社外監査役です。

監査役と社長直轄の監査室ならびに会計監査人の連携も緊密に行われており、監査体制、監査計画および実施状況などについて定期的に会合を持ち意見交換を行っています。

### 3. 社内カンパニー制および執行役員制

当社は、開発計画におけるスピーディーな意思決定や市場動向への迅速かつ柔軟な対応などを強化するために、2002年4月に社内カンパニー制と執行役員制を導入し、社内を半導体社、計測社、業務会社の3つのカンパニーに分けました。全てのオペレーションは、この3つのカンパニーで行っています。半導体社、計測社および業務会社は、完結した組織として、それぞれのお客様に一層機動的かつ迅速に対応できるようになりました。代表取締役社長CEOが定例の経営執行会議を毎月1回開催し、業務計画の進捗状況について監督などを行っています。

### 4. 監査室

当社は、代表取締役社長に直属する部署として、監査室を設置しています。監査室は、内部監査規定に則り計画的に監査を実施しており、定期

的に監査実施項目および実施方法を検証し、必要があれば改訂を行います。監査室の監査により、法令定款違反、会社規程違反またはその他の事由に基づく損失の危険のある業務執行行為が発見された場合には、監査室長は直ちに代表取締役社長に報告するとともに、是正・改善を指示し実施します。

## 5. 経営支援室

代表取締役社長に直属する当社の経営支援室が、子会社を含めた当社グループに内在する諸問題または重大なリスク情報などを取り上げ、グループ全体の利益の観点から、グループにおける情報の共有と業務執行の適正を確保することに努めています。

経営支援室は、当社と子会社に関する不適切な取引または会計処理を防止するため、当社および子会社の監査室またはこれに相当する部署と十分な情報交換を行っています。

## 内部統制システムに関する基本的な考え およびその整備状況

### 基本的な考え方

当社は、お客様、お取引先、株主の皆様、使用人など全てのステークホルダーの方々との間で、WIN-WINの関係を創り上げ、長期的に成長を持続させていくために、実効性ある内部統制システムとコンプライアンスの強化に取り組み、経営の健全性と透明性を確保し、グループ経営を行っています。

### 内部統制システムに関する整備状況

- 当社は、取締役会が実効性ある内部統制システムの構築と法令定款遵守の体制の確立に努め、監査役会が内部統制システムの有効性と機能を監査します。
- 社長直轄の組織として、監査室、経営支援室および輸出管理業務室を設け、当社と子会社に係る法令等の遵守状況を監査するとともに損失の危険の管理と業務の適正確保に努めています。
- 当社は全社員の職務執行が法令・定款遵守に適合することを確保するために、「ACCURETECHグループ行動規範」を定めるとともに、「コンプライアンス委員会」、「情報セキュリティ委員会」、「環境管理委員会」、「安全衛生委員会」および「内部通報制度」などの体制を構築しています。
- 当社は業務執行に係るリスクの把握とその管理を目的とした「リスク管理規定」を定め、代表取締役社長を責任者とする「リスク管理委員会」を設けています。「リスク管理委員会」はリスクの発生予防と危機発生に備えた体制整備を行います。
- 当社は監査役の職務を補助する体制や、監査が実効的に行われることを確保する体制も構築しています。

## 環境への取り組み

### 基本理念

当社は、「環境との調和による地球にやさしい仕事を目指す」をモットーに、地球環境保全が人類共通の重要課題であることを認識し、生産・サービスの全域において積極的に環境保全に配慮した行動をとることを基本理念としています。

### 環境基本方針

環境保全活動の基本方針は、全社員が、生産からサービスまで全ビジネス領域において、常に「この行動は地球にやさしいか」を配慮し、環境負荷を可能な限り少なくする努力をすることです。当社では、「環境管理委員会」が中心となって環境管理体制を組織し、環境関連の法律、条令、協定および当社の「環境方針」を遵守し、環境保全活動を推進しています。

また、全社員に対し環境保全に関する教育普及を行い、意識の向上を図るとともに、協力会社の工場に対しても当社の環境保全活動への理解が得られるよう努力しています。

### 環境行動方針

1. 「環境管理委員会」を頂点とする、全職制を軸にした環境管理体制を組織し、揺るぎない環境保全活動を推進する。
2. 環境関連の法律、条例、協定および本「環境方針」を遵守し、自主目標を設定して、汚染防止、環境保全に取り組む。
3. 環境に配慮した製品の開発・改善に努める。
4. 事業活動にともなう環境影響に関する以下の項目等について環境目的・環境目標に定め、継続的な活動を行うと共に内部監査等で見直しを行う。
  - 省エネルギー・省資源・廃棄物の削減・リサイクルへの取り組み、天然資源の有効利用
  - 有害物質の適正管理による汚染の予防、環境負荷の高い物質の使用量削減
  - 環境に配慮した新製品の開発および既存製品の改良
5. 全社員に対し、環境保全に関する教育訓練を行い、意識の向上を図る。また、協力工場に対しても環境保全活動についての理解と協力を求める。
6. この「環境方針」は社内外に開示する。

#### 環境・社会報告書の発行

今年度の環境・社会報告書は8月に発行の予定です。この報告書は当社のWebサイトでもご覧いただけます。

<http://www.accretech.jp/>



藤森 一雄

太田 邦正

長澤 英二

鈴木 貞勝

## 取締役及び監査役

(2006年6月29日現在)

代表取締役社長  
CEO兼COO  
鈴木 貞勝

代表取締役EVP  
藤森 一雄  
長澤 英二  
太田 邦正

取締役  
梅中 茂  
ウォルフガング・ボナッツ  
グレッグ・セバスチャン  
吉田 均  
木村 龍一

常勤監査役  
高城 英明  
監査役  
山本 清次  
久富 眞志  
川原 栄次  
高田 宥

## 6年間の主要財務データ

株式会社東京精密及び連結子会社  
2002年～2007年の3月31日に終了した各年度

会計年度：	百万円						千米ドル
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2007
売上高	¥ 34,064	¥ 47,171	¥ 62,324	¥ 84,750	¥ 92,845	¥ 100,322	\$ 849,544
営業利益（損失）	(1,757)	1,860	5,947	13,051	13,991	14,086	119,285
当期純利益（損失）	(2,026)	74	(3,783)	4,459	3,125	8,741	74,023
<b>会計年度末：</b>							
総資産	79,865	88,669	94,893	100,993	109,875	114,831	972,407
純資産	35,423	33,645	29,183	33,003	46,703	54,281	459,665
有利子負債	31,145	33,531	36,253	31,273	27,726	24,613	208,430
<b>1株当たり：</b>							
当期純利益（損失） - 希薄化前	¥ (54.21)	¥ 1.64	¥ (101.67)	¥ 118.82	¥ 80.77	¥ 217.91	\$ 1.85
- 希薄化後	—	1.64	—	108.75	74.02	203.10	1.72
従業員数（人）	1,146	1,101	1,100	1,144	1,169	1,235	

注：米ドル金額は2007年3月31日における換算レート、すなわち1米ドル118円09銭で便宜上換算している。

## 目次

27	6年間の主要財務データ
28	財務報告
33	連結貸借対照表
35	連結損益計算書
36	連結株主資本等変動計算書
37	連結キャッシュ・フロー計算書
38	連結財務諸表注記
56	監査報告書

# 財務報告

## 概況

当社は、半導体製造装置および計測機器のメーカーです。市場の変化が激しく、常に最新技術が要求される環境下において、当社が持続的な成長を続けていくためには、適正な基準に準拠した製品開発を、強力な体制で行っていくことが重要となります。そのため、独自の「製品開発の原則」に則った経営を行うことにより、市場の設備投資動向による影響を最小限に抑えながら、高成長・高収益のビジネス基盤を構築しています。

当社は、対処すべき課題として、新規参入製品事業の成功と財務構成の改善を掲げています。当社は、ここ数年来、半導体新規参入製品の開発を積極的に進めてきました。新規参入製品はこれまでの数年で売上拡大への貢献は実現させてきましたが、利益へのさらなる貢献が期待されていました。今後は、売上拡大を一層推進すると共に、コストダウンとお客様のニーズを的確に把握した営業活動により、利益率を目標ラインまで向上させていくように注力いたします。

当社の財務構成は、ここ数年で格段に改善されましたが、さらなる品質向上と生産革新を推進し、売上・利益の大幅な拡大を図り、財務諸比率のさらなる向上を目指します。

## 売上高

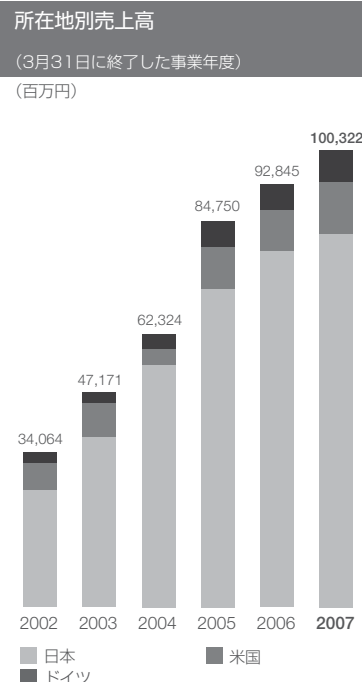
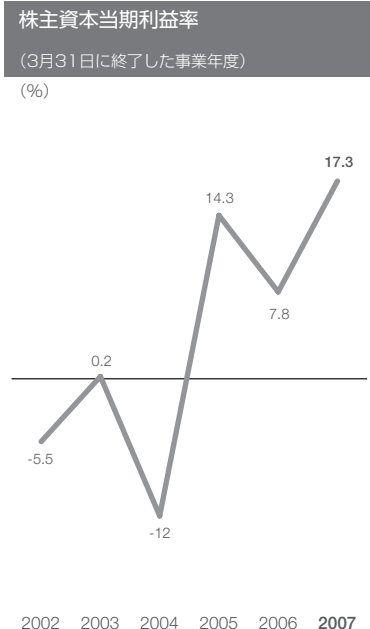
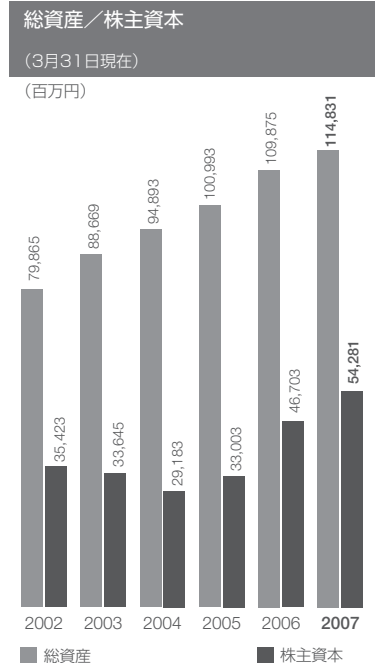
2007年3月期の売上高は、当社を取り巻く経営環境が上期を中心に半導体製造装置事業、計測機器事業ともに良好であった

こともあり、前期比8.1%増の100,322百万円となり、3年連続の既往ピーク更新となりました。

半導体業界は、薄型テレビ・携帯音楽プレーヤーなどのデジタル・コンシューマ機器の需要増やパソコンの好調などにより、メモリーデバイスメーカーを中心に半導体メーカーの設備投資は旺盛で、製造装置に対する需要も伸長しました。第3四半期には、好調であった上期の反動もあり、調整局面もありましたがその後回復し、全般的には市況は好調でした。これを反映して、半導体製造装置事業の売上高は、前期比8.7%増の78,091百万円と過去最高を更新しました。

計測機器事業は、国内の自動車メーカーの一部で設備投資抑制の動きがあるものの、航空機業界や建設機械業界などからのユーザーニーズの顕在化や自動車関連や工作機械の海外での拡販により、売上高は前期比5.8%増の22,230百万円と過去最高を更新し、2003年度以降、4期連続既往ピークを更新しています。

半導体製造装置、計測機器合算の売上高を地域別に見ると、国内の売上高は、前期比10.4%増の49,860百万円で、全体の49.7%を占めました。海外地域では、東アジアへの売上高は前期比8.1%減の28,709百万円、北米は前期比29.5%増の9,121百万円、ヨーロッパは前期比45.6%増の7,332百万円、その他の地域は前期比21.1%増の5,299百万円となりました。結果として、海外売上高は前期比5.8%増の50,462百万円となり、全体の50.3%を占めました。



**【半導体製造装置事業】**

既存製品群の主力であるウェーハプロービングマシンについては、デバイス需要の好調とウェーハでのフルテストの必要性の高まりなどを背景に、市況は極めて活発でした。あらゆるデバイスメーカーのニーズをカバーするフルオートタイプである300mm対応機の「UF3000」が前期比大きく伸長するとともに、台湾向けなどに200mm対応の最新モデル「UF2000」も堅調に推移し、過去最高の売上高を達成し、当社業績の柱となっています。当社は、ウェーハプロービングマシンのNo.1プレーヤーとして、最新モデル「UF3000EX」により世界的にシェアをさらに拡大してまいります。

ウェーハダイシングマシンも、堅調に推移しました。また、2004年度より販売開始した新型レーザダイサ「MAHOHDICING MACHINE」は、ユーザーからその性能および生産性を高く評価され、当期の販売は、MEMS向けやイメージセンサー向けなどに前期比倍増となりました。リピートオーダーや薄物ウェーハ向けなどの新規需要も増加しており、今後の一層の拡販が期待されます。

新規参入製品群のウェーハ外観検査装置は、低いコスト・オペレーターシップや高い欠陥検出率などが高く評価され、既存ユーザーからリピートオーダーをいただくとともに新規ユーザーも増えており、新たに高いスループットのシリーズを加えて、多岐にわたるユーザーニーズに応えております。

また、ウェーハ薄片化において他の追随を許さない独自製品であるポリッシュ・グラインダは、300mmウェーハ対応機である「PG300RM」の需要が堅調です。薄物ウェーハのニーズは、引き続き増加していくと考えられていますが、この市場はこれまでの韓国地域が牽引する状況から台湾・中国・東南アジアなど他のアジア地域へ市場が拡大しました。競合の参入や一部地域で設備投資の抑制があったことから一時的に受注・売上とも影響を受けましたが、市況は回復しております。今後薄片化ニーズが一層進展するなかで当社の技術的優位性がより明確になり、市場のリーダーとしてのポジションを堅持していく見込みです。

さらに、CMP装置も、「ChaMP」シリーズのコンセプトや構造の優位性がお客様に浸透しております。高度な研磨技術が要求される銅配線などで高い評価をいただいております。今後の拡販が期待されます。

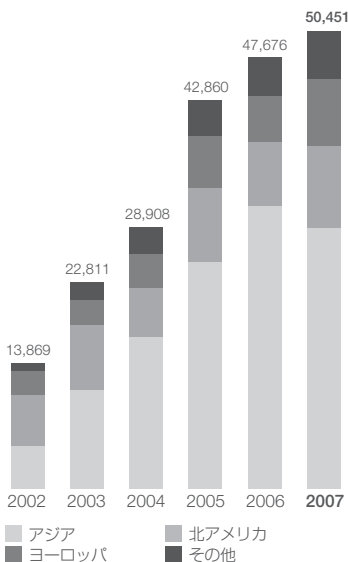
**【計測機器事業】**

汎用計測機器では、カール ツァイス社のラインレーザ搭載の三次元座標測定機や「ザイザックスSVA」シリーズが、お客様のニーズに合った製品として好調であり、スキャニング高精度保証の「ザイザックスSVA fusion」も順調です。カールツァイス社の新製品「ゲージマックス」は、インラインで使用される三次元座標測定機で、今後の伸びが期待されます。また、リ

**海外売上高**

(3月31日に終了した事業年度)

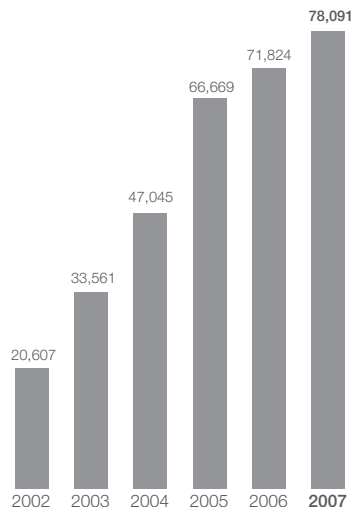
(百万円)



**半導体製造装置事業売上高**

(3月31日に終了した事業年度)

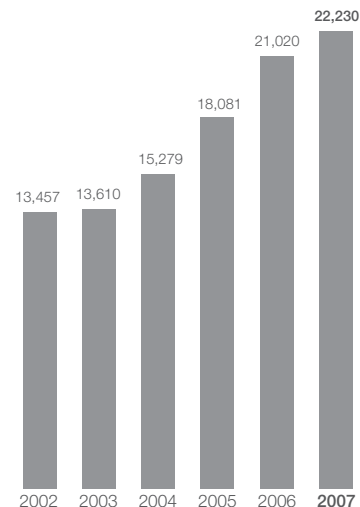
(百万円)



**計測機器事業売上高**

(3月31日に終了した事業年度)

(百万円)



ニアモータ採用で世界最高精度と低振動を実現した表面粗さ形状測定機「サーフコム」シリーズも、「サーフコム1500DX」や「コンターレコード1700DX」などを中心に堅調に推移しています。高精度で高評価を得ている真円度測定機「ロンコム」シリーズでは、「ロンコム54DX/44DX」や「ロンコム72A」「ロンコム75GB」などの売上が順調に拡大しています。

自動計測機器は、国内の自動車産業の設備投資の調整を受けて、自動車の部品生産ラインなどで使用される「バルコム」シリーズは伸び悩みが好調で、売上高は前年比減少となりました。

### 売上原価

2007年3月期の売上原価は、前期比9.6%増加し72,211百万円となり、売上原価比率は70.9%から72.0%へと上昇しました。これは、固定費削減、内製化推進による変動比率引き下げなどのコストダウン施策を推進したものの、新モデルの投入で一時的に原価高になったことなどによるものです。

### 販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費は、販売費が10,593百万円、一般管理費が3,431百万円となり、合算では前期比8.1%増加し14,025百万円となりました。売上高販管費率としては2006年3月期と変わらず14.0%でした。

### 営業利益

2007年3月期は、前期比0.7%増の14,086百万円の営業利益を計上し、売上高営業利益率は15.4%から14.0%になりました。

部門別の内訳については、半導体製造装置事業は、既存製品群の新製品投入に関わる開発費負担やポリッシュ・グラインダの一部地域における採算の低下により、営業利益は、前期比1.6%減の8,830百万円と、減益を余儀なくされました。計測機器事業では、販売面だけではなく、生産面でのコストダウンも実現し、前期比4.7%増の5,256百万円の営業利益を計上し、4期連続で過去最高を更新しました。

### 営業外収益および費用

2007年3月期の営業外収益は、前期のような大きな為替差益の要因がなく、前期比667百万円減少し、208百万円となりました。また営業外費用でも同様に、前期のような大きな固定資産除却損の要因がなかったことや支払利息が減少したことにより、前期比154百万円減少し、681百万円となりました。

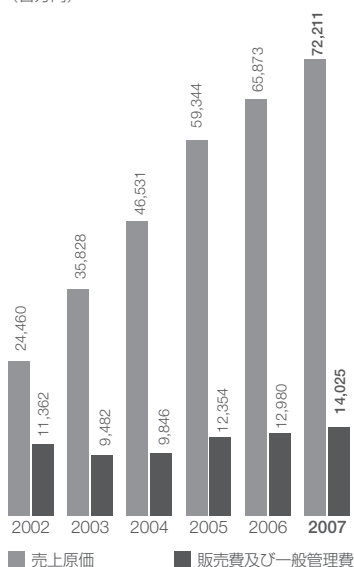
### 当期純利益

訴訟関連費用などによる特別損失の計上が、569百万円ありました。税金等調整前当期純利益は、13,198百万円で法人税等の4,457百万円があり、当期純利益は8,741百万円となりました。

#### 売上原価／販売費及び一般管理費

(3月31日に終了した事業年度)

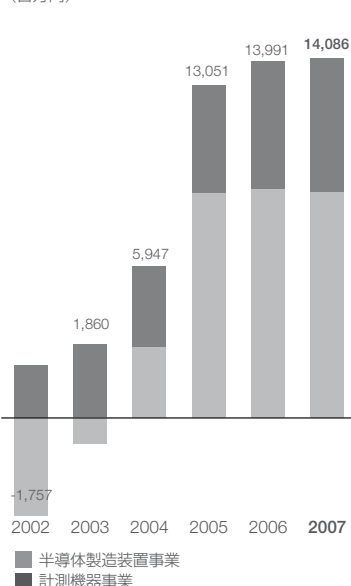
(百万円)



#### 営業利益

(3月31日に終了した事業年度)

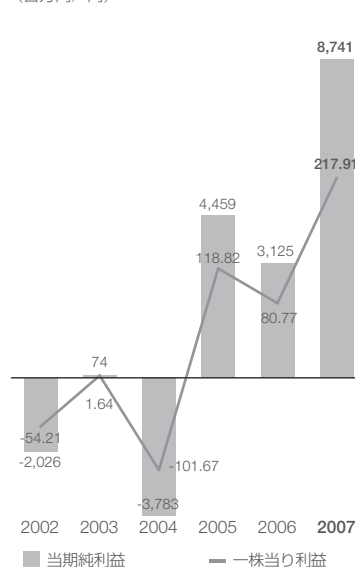
(百万円)



#### 当期純利益／一株当たり利益

(3月31日に終了した事業年度)

(百万円／)



### 配当

当期の配当に関しては、中間配当として一株当たり25円を実施しました。期末配当も一株当たり25円とし、一株当たり年間配当で50円を実施しました。当社は、これまで当期純利益の20%を目途に配当してまいりましたが、今後は、株主の皆様への還元をより重視する観点から配当性向を引き上げることとし、配当性向30%を目途に実施していく方針です。

### 研究開発費

2007年3月期の試験研究費は、前期比3.5%減少し、7,639百万円となりました。当社は、「製品開発の原則」に則り、引き続き世界No.1の製品開発に注力しています。半導体製造装置事業では、ウェーハの大口径化や微細化・薄片化への対応など、市場ニーズにマッチした次世代装置をタイムリーに投入していくための試験研究に注力します。また、計測機器事業でも、高精度かつ高いコストパフォーマンスを実現した新機種を引き続き投入していきます。

### 設備投資

2007年3月期の設備投資は、前期比ほぼ同レベルの2,511百万円となりました。2008年3月期は、土浦・八王子の工場新・増設や内製化への推進のための設備投資を計画しており、従来水準よりも高い6,840百万円を予定しています。また、

2007年3月期の減価償却費は、前年とほぼ同レベルの2,882百万円となりました。2008年3月期は、ソフトウェアの償却を終了すること、今期の設備投資の償却負担が比較的小さいことなどから前期比742百万円減少の2,140百万円を予定しております。

### 為替

当社は、為替に関し、北米などの一部を除き原則として円建てで取引を行っていますので、為替変動によるリスクを低く抑えることが可能となっています。外貨建て取引を行っている米国子会社などに対する売掛金については、為替変動のリスクに備えるため、必要に応じて為替予約取引を利用しています。この取引は実需に基づく為替予約に限定しており、投機目的などのデリバティブ取引は行っており、リスク管理は正当に遂行されています。

### 貸借対照表

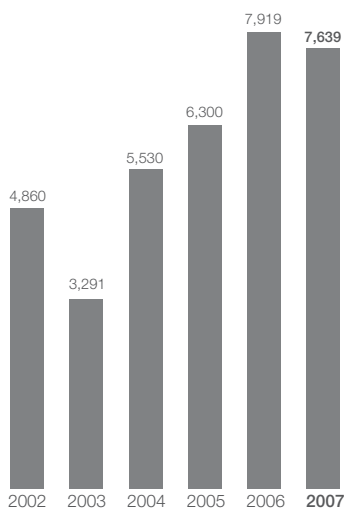
2007年3月末の総資産は前期比4,956百万円増の114,831百万円となりました。流動資産は前期比5,494百万円増の86,561百万円となりました。資産の増加は、現金及び預金の増加ならびに売上増に伴う売上債権の増加などによるものです。固定資産はほぼ同レベルの、28,270百万円となりました。

負債合計は、前期比2,623百万円減の60,549百万円となり

#### 研究開発費

(3月31日に終了した事業年度)

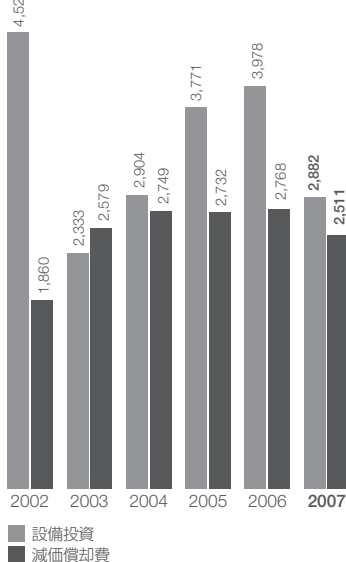
(百万円)



#### 設備投資／減価償却費

(3月31日に終了した事業年度)

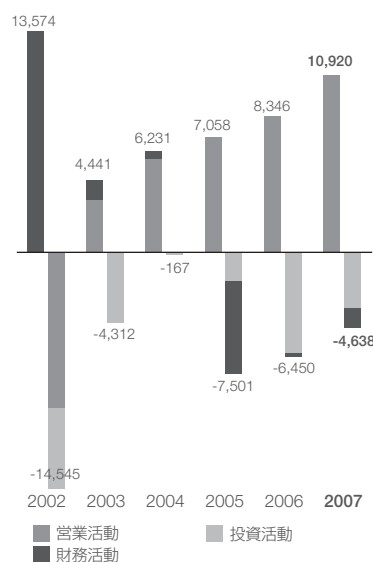
(百万円)



#### キャッシュ・フロー

(3月31日に終了した事業年度)

(百万円)



ました。これは、未払い法人税等で2,289百万円増加した一方で、仕入れ債務が若干減少し、また短期借入金で2,938百万円、社債合計で701百万円減少したことなどによるものです。

2007年3月末の自己資本比率は47.1%となり、前期より大幅に上昇しました。2008年3月期は、約50%と予想しています。当社の総資産回転率は、2007年3月期は0.9と着実に好転しております。同様に在庫回転率も改善しており、2007年3月期の在庫回転率は3.7で、2008年3月期には4.0になる見込みです。

### キャッシュ・フロー

2007年3月期末における現金及び現金同等物は、前期末より2,949百万円増加し、16,800百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは10,920百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前当期純利益13,198百万円、減価償却費2,468百万円、売上債権の増加3,096百万円、仕入債務の減少1,379百万円などによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは3,439百万円の支出となりました。これは有形固定資産の取得3,144百万円などによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは4,638百万円の支出となりました。これは主に、短期借入金の減少2,938百万円、長期借入金合計の増加526百万円、配当金の支払1,804百万円などによるものです。

今後も利益拡大とキャッシュ・フロー改善などにより、営業キャッシュ・フローのプラスが見込まれ、より良い財務状況を構築できる見込みです。

### リスク要因

当社の今後の業績に影響を与えるリスク要因としては以下のようなの考えられます。

### 市場の変動

半導体業界は、情報化社会の進展の中で長期的には拡大基調を続けていくものの、シリコンサイクルは今後も起こり得ます。市場変動により半導体製造装置事業の業績が影響を受ける可能性があります。当社グループはそのような市場変動の中でも継続的に利益を確保できる収益体質の構築に注力しています。

### 為替レートの変動

輸取出引については、円建てを原則としていますが、米国など一部ユーザーとは米ドル建てとなっています。為替予約などを活用しリスクヘッジを行っていますが、為替レートに予期せぬ変動が生じた場合、当社グループ業績に影響を与える可能性があります。

### 知的財産権の保護

当社グループの製品はいずれも最先端技術を搭載したブランド力のある製品で、その特許関係の権利帰属および商標・ブランドの保護などに特別な配慮をし、会社の利益が損なわれないように施策を講じていますが、やむを得ず第三者との間で権利関係をめぐる訴訟などが発生した場合は、業績に影響が及ぶ可能性があります。

### カントリーリスクその他

当社グループは全世界で事業展開をしており、各国の法的規制の下で最適な事業活動を行っていますが、各国の予期せぬ法的規制の変更が当社グループの業績に影響を与える可能性がないとはいえません。また、一般的可能性としてテロ、戦争、自然災害などの予期せざる事象が発生した場合も、業績に影響が及ぶ可能性があります。

# 連結貸借対照表

株式会社東京精密及び連結子会社  
2006年及び2007年3月31日現在

	百万円		千米ドル (注1)
	2006	2007	2007
<b>資産</b>			
<b>流動資産：</b>			
現金及び現金同等物 (注 15)	¥ 13,887	¥ 16,826	\$ 142,484
受取手形及び売掛金 (注 12)	36,437	39,717	336,328
たな卸資産 (注 4)	27,053	27,207	230,398
繰延税金資産 (注 7)	1,447	1,607	13,610
その他	2,294	1,231	10,429
貸倒引当金	(53)	(28)	(239)
流動資産合計	81,067	86,561	733,013
<b>有形固定資産：</b>			
土地	2,937	3,002	25,427
建物及び構築物	12,474	13,454	113,932
機械装置	5,030	5,615	47,552
建設仮勘定	518	452	3,829
その他	3,689	3,844	32,559
	24,649	26,369	223,300
減価償却累計額	(10,332)	(11,188)	(94,746)
有形固定資産合計	14,317	15,180	128,553
<b>無形固定資産：</b>			
ソフトウェア	1,451	608	5,150
のれん	3,301	2,888	24,462
その他	83	92	786
無形固定資産合計	4,837	3,589	30,399
<b>投資その他の資産：</b>			
投資有価証券 (注 3)	5,662	5,728	48,506
非連結子会社及び関連会社への投資	299	414	3,507
繰延税金資産 (注 7)	1,907	1,551	13,136
その他	1,793	1,818	15,398
貸倒引当金	(9)	(12)	(107)
投資その他の資産合計	9,653	9,499	80,441
固定資産合計	28,807	28,270	239,394
資産合計	¥ 109,875	¥ 114,831	\$ 972,407

添付の注記は連結財務諸表の一部である。

	百万円		千米ドル (注1)
	2006	2007	2007
<b>負債及び純資産</b>			
<b>流動負債：</b>			
支払手形及び買掛金（注 12）	¥ 24,807	¥ 23,596	\$ 199,813
短期借入金（注 5）	6,830	4,485	37,980
未払費用	1,788	1,678	14,217
未払税金	1,193	3,483	29,495
その他	3,480	3,068	25,987
流動負債合計	38,099	36,312	307,495
<b>固定負債：</b>			
長期債務、1年内を除く（注 5）	20,896	20,128	170,450
退職給付引当金（注 6）	4,175	4,109	34,796
固定負債合計	25,072	24,237	205,246
<b>偶発債務（注 11）</b>			
<b>純資産：</b>			
<b>株主資本（注 8、17）</b>			
資本金			
授權株式数：110,501,100株（2007年及び2006年）			
発行済株式数：40,187,517株（2007年）		9,592	81,226
：40,100,167株（2006年）	9,447		
資本剰余金	20,466	20,611	174,541
利益剰余金	15,399	22,322	189,027
自己株式：28,215株（2007年）		(101)	(855)
：26,421株（2006年）	(90)		
株主資本合計	45,223	52,424	443,940
<b>評価・換算差額等</b>			
その他有価証券評価差額金	1,340	1,416	11,993
為替換算調整勘定	139	257	2,177
評価・換算差額合計	1,479	1,673	14,171
<b>新株予約権（注 16）</b>			
純資産合計	46,703	54,281	459,665
負債純資産合計	¥ 109,875	¥ 114,831	\$ 972,407

添付の注記は連結財務諸表の一部である。

# 連結損益計算書

株式会社東京精密及び連結子会社  
2006年及び2007年3月31日に終了した年度

	百万円		千米ドル (注1)
	2006	2007	2007
<b>売上高</b>	¥ 92,845	¥ 100,322	\$ 849,544
<b>売上原価 (注 13)</b>	65,873	72,211	611,493
売上総利益	26,971	28,111	238,051
<b>販売費及び一般管理費 (注 13)</b>	12,980	14,025	118,765
営業利益	13,991	14,086	119,285
<b>営業外収益 :</b>			
受取利息	19	46	393
その他収益	855	161	1,370
<b>営業外費用 :</b>			
支払利息	272	259	2,197
その他費用	563	422	3,577
経常利益	14,031	13,612	115,274
<b>特別利益 :</b>			
投資有価証券売却益	93	—	—
その他利益	22	155	1,316
<b>特別損失 :</b>			
たな卸資産評価損及び廃却損	2,862	—	—
固定資産除却損	1,387	—	—
リース解約費用	1,854	—	—
その他損失	178	569	4,824
税金等調整前当期純利益	7,865	13,198	111,766
<b>法人税等 (注 7)</b>			
当年度分	1,690	4,310	36,499
法人税等調整額	2,851	146	1,243
	4,541	4,457	37,742
<b>少数株主利益</b>	198	—	—
当期純利益	¥ 3,125	¥ 8,741	\$ 74,023
	円		米ドル (注1)
<b>1株当たり (注 14) :</b>			
純資産	¥ 1,165.07	¥ 1,347.09	11.41
当期純利益 - 希薄化前	80.77	217.91	1.85
- 希薄化後	74.02	203.10	1.72
年間配当額	40.00	50.00	0.42

添付の注記は連結財務諸表の一部である。

# 連結株主資本等変動計算書

株式会社東京精密及び連結子会社

2006年及び2007年3月31日に終了した年度

	千株		百万円						
	株式数	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	自己株式	その他 有価証券 評価 差額金	為替換算 調整勘定	新株 予約権	
<b>2005年3月31日残高</b>	37,495	¥ 7,392	¥ 12,017	¥ 13,596	¥ (63)	¥ 70	¥ (9)	¥ -	
当期純利益	-	-	-	3,125	-	-	-	-	
新株予約権の権利行使	180	287	287	-	-	-	-	-	
転換社債型新株予約権付社債の転換	690	1,767	1,767	-	-	-	-	-	
株式交換	1,711	-	6,218	-	-	-	-	-	
配当金	-	-	-	(1,312)	-	-	-	-	
役員賞与	-	-	-	(9)	-	-	-	-	
自己株式の取得	(4)	-	-	-	(26)	-	-	-	
自己株式の処分	0	-	175	-	-	-	-	-	
その他有価証券評価差額金	-	-	-	-	-	1,270	-	-	
為替換算調整勘定	-	-	-	-	-	-	149	-	
<b>2006年3月31日残高</b>	40,073	¥ 9,447	¥ 20,466	¥ 15,399	¥ (90)	¥ 1,340	¥ 139	¥ -	
当期純利益	-	-	-	8,741	-	-	-	-	
新株予約権の権利行使	86	143	143	-	-	-	-	-	
転換社債の転換	0	0	0	-	-	-	-	-	
配当金	-	-	-	(1,804)	-	-	-	-	
役員賞与	-	-	-	(14)	-	-	-	-	
自己株式の取得	(1)	-	-	-	(11)	-	-	-	
自己株式の処分	0	-	0	-	0	-	-	-	
その他有価証券評価差額金	-	-	-	-	-	75	-	-	
為替換算調整勘定	-	-	-	-	-	-	118	-	
新株予約権の発行	-	-	-	-	-	-	-	183	
<b>2007年3月31日残高</b>	40,159	¥ 9,592	¥ 20,611	¥ 22,322	¥ (101)	¥ 1,416	¥ 257	¥ 183	

	千米ドル (注 1)						
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	自己株式	その他 有価証券 評価 差額金	為替換算 調整勘定	新株 予約権
<b>2006年3月31日残高</b>	\$ 80,003	\$ 173,313	\$ 130,405	\$ (762)	\$ 11,351	\$ 1,177	\$ -
当期純利益	-	-	74,023	-	-	-	-
新株予約権の権利行使	1,219	1,218	-	-	-	-	-
転換社債の転換	4	4	-	-	-	-	-
配当金	-	-	(15,279)	-	-	-	-
役員賞与	-	-	(122)	-	-	-	-
自己株式の取得	-	-	-	(97)	-	-	-
自己株式の処分	-	4	-	5	-	-	-
その他有価証券評価差額金	-	-	-	-	641	-	-
為替換算調整勘定	-	-	-	-	-	1,000	-
新株予約権の発行	-	-	-	-	-	-	1,554
<b>2007年3月31日残高</b>	\$ 81,226	\$ 174,541	\$ 189,027	\$ (855)	\$ 11,993	\$ 2,177	\$ 1,554

添付の注記は連結財務諸表の一部である。

# 連結キャッシュ・フロー計算書

株式会社東京精密及び連結子会社  
2006年及び2007年3月31日に終了した年度

	百万円		千米ドル (注1)
	2006	2007	2007
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー：</b>			
税金等調整前当期純利益	¥ 7,865	¥ 13,198	\$ 111,766
減価償却費*	2,939	2,882	24,405
株式報酬費用	—	183	1,554
貸倒引当金の減少	(8)	(25)	(217)
退職給付引当金の減少	(110)	(66)	(566)
受取利息及び受取配当金	(75)	(114)	(972)
支払利息	272	259	2,197
投資有価証券評価損	60	50	423
ゴルフ会員権評価損	44	—	—
土地売却益	(1)	0	0
固定資産売却・除却損	1,704	145	1,235
無形固定資産除却損	19	—	—
投資有価証券売却益	(93)	1	16
売上債権の増加	(4,043)	(3,096)	(26,218)
たな卸資産の増減	1,152	(382)	(3,241)
仕入債務の増減	6,546	(1,379)	(11,684)
その他資産負債の増減	(4,443)	1,594	13,503
役員賞与	(9)	(14)	(122)
小計	11,817	13,235	112,077
利息及び配当金の受取額	75	114	972
利息の支払額	(284)	(265)	(2,248)
法人税等の支払額	(3,261)	(2,164)	(18,326)
営業活動により増加したキャッシュ	8,346	10,920	92,475
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー：</b>			
預入期間3ヶ月を超える定期預金の払込	(1,048)	(38)	(321)
預入期間3ヶ月を超える定期預金の払出	38	48	406
投資有価証券の取得による支出	(140)	(1,500)	(12,709)
関係会社有価証券の取得による支出	(163)	(113)	(963)
投資有価証券の売却による収入	85	1,509	12,786
有形固定資産の取得による支出	(4,821)	(3,144)	(26,631)
有形固定資産の売却による収入	87	134	1,141
無形固定資産の取得による支出	(242)	(165)	(1,404)
その他	44	(168)	(1,430)
投資活動により減少したキャッシュ	(6,160)	(3,439)	(29,127)
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー：</b>			
短期借入金の増減	2,598	(2,938)	(24,883)
長期借入れによる収入	2,500	4,000	33,872
長期借入金の返済による支出	(4,660)	(3,473)	(29,413)
社債償還による支出	(450)	(700)	(5,927)
新株予約権の権利行使による収入	646	287	2,438
自己株式の売却収入	495	—	—
配当金の支払額	(1,312)	(1,804)	(15,279)
その他	(108)	(10)	(88)
財務活動により減少したキャッシュ	(290)	(4,638)	(39,281)
現金及び現金同等物の換算差額	117	106	904
現金及び現金同等物の増加額	2,012	2,948	24,971
現金及び現金同等物の期首残高	11,838	13,851	117,295
現金及び現金同等物の期末残高(注15)	¥ 13,851	¥ 16,800	\$ 142,267

添付の注記は連結財務諸表の一部である。  
(※) 減価償却費にはのれんの償却額が含まれている。

# 連結財務諸表注記

株式会社東京精密及び連結子会社

## 1. 連結財務諸表の基本事項

株式会社東京精密（以下 当社）及びその連結子会社の連結財務諸表は、日本の証券取引法及び関連する諸規則に基づき日本において一般に公正妥当と認められる会計原則及び慣行に従って作成されている。日本で一般に公正妥当と認められる会計原則及び慣行は、いくつかの点で国外において一般に公正妥当と認められる会計原則及び慣行と相違する可能性がある。添付の連結財務諸表を国外において一般的な表示様式とするため、表示の組替を行っている。連結財務諸表の注記事項には、日本で一般に公正妥当と認められる会計原則及び慣行では認められて

いない財務情報が追加的に含まれている。連結財務諸表上の米ドル金額は、便宜上記載されたものであり、2007年3月31日における実勢為替相場1米ドル=118円09銭で換算されている。換算額は、当該レートまたは他の換算レートにより円貨をドル貨に交換した、または交換できたことを示すものではない。

百万円未満の金額を切り捨てて表示しているため、連結財務諸表上の合計金額（円及び米ドル）は個々の金額の合計値とは必ずしも一致しない。前年度の連結財務諸表に記載された一部の金額は、当年度の表示方法に合わせて組替表示している。

## 2. 重要な会計方針の要約

### (1) 連結の方針

添付の連結財務諸表は2006年3月31日現在及び2007年3月31日現在における子会社7社を連結している。2006年3月31日現在及び2007年3月31日現在における残りの子会社10社は、その総資産、売上高及び利益に重要性がないため連結対象から除いている。

連結子会社の取得日における投資原価と純資産の公正価値との差額は、のれんとして計上し、その個別案件ごとに判断し、合理的な年数(10年)にわたり、定額法にて償却している。

すべての重要な関係会社間の取引、勘定及び未実現利益は消去している。重要性のない関連会社及び非連結子会社への投資は、取得原価あるいはそれ以下の金額で評価されている。当該投資に回復見込みのない減損が生じた場合には、評価減を実施している。剰余金の処分は株主総会決議または取締役会決議がなされた期において認識している。

### (2) 現金及び現金同等物

現金及び現金同等物には手許現金、要求払い預金及び短期かつ流動性の高い投資で、取得時において満期が3ヶ月以内の価値変動リスクが僅少なものからなっている。

### (3) 有価証券

投資有価証券のうち、時価のあるものについては時価で評価し、その未実現損益は利益の構成要素とはせず、税効果控除後の金額で純資産の部の独立項目としている。売却された有価証券の売却原価は移動平均法に基づいて計算している。

投資有価証券のうち、時価のないものについては移動平均法による原価法で評価している。

### (4) デリバティブ取引

デリバティブ取引は、一般的に時価で評価されることが求められている。しかしながら、当社は輸出取引に際して発生する為替変動リスクの回避を目的とした為替予約取引と借入金に際して発生する金利変動リスクの回避を目的とした金利スワップ取引を利用している。金融商品に係る会計基準で容認されている為替予約の振当処理と金利スワップの特例処理を適用している。

投機目的のデリバティブ取引は行っていない。契約先は国内の高い信用を持った銀行であるため、当社は相手先の為替予約契約不履行によるいかなる信用リスクも想定していない。当社は国内規則に従い重大な為替変動リスクと金利変動リスクをヘッジしている。

### (5) たな卸資産

当社及び国内の連結子会社のたな卸資産は、仕掛品を除き、先入先出法による原価法を採用している。仕掛品は個別法による原価法によっている。

国外の連結子会社のたな卸資産は先入先出法による低価法で評価している。

### (6) 有形固定資産

有形固定資産は取得原価で表示している。当社及び国内の連結子会社における減価償却は各資産毎に見積残存期間に基づき、主として定率法によっている。

国外の連結子会社における減価償却は見積残存期間に基づく定額法によっている。

主な耐用年数は以下のとおりである。

建物及び構築物	3年～50年
機械装置及び運搬具	2年～11年

### (7) 無形固定資産

無形固定資産は取得原価から減価償却累計額を控除した金額で表示している。販売用ソフトウェアは、予定販売数量に対する当期の販売数量の比率ないし残存有効期間に基づく定額法のうち、いずれか大きい金額で減価償却している。自社利用のソフトウェア及びその他の無形固定資産は、それぞれ社内における利用可能期間及び使用可能期間に基づく定額法によっている。

### (8) リース

解約不能なリース取引は、原則として、オペレーションリースとして処理している。ただし、リース期間満了時にリース物件の所有権が移転するリース取引については、ファイナンスリースとして処理している。

**(9) 貸倒引当金**

債権の貸倒れによる損失に備えるため貸倒引当金を計上している。貸倒引当金は個々の貸倒懸念債権の回収可能性及び過去の貸倒実績に基づき、見積回収不能額を計上している。

**(10) 退職給付引当金**

退職給付引当金は事業年度末の退職給付債務及び年金資産の見積りに基づき計上している。

数理計算上の差異は、従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)にわたり定額法で翌年度から費用処理している。

また、当社及び国内の連結子会社は、全ての取締役及び監査役が貸借対照表日に退任した場合の支給見込額を取締役及び監査役に対する退職慰労引当金として計上している。なお、当社は、2006年3月31日に終了した事業年度より、取締役及び監査役に対する退職慰労金制度を廃止している。2006年3月31日現在、取締役分については2005年3月31日、監査役分については2005年6月30日時点の支給見込み額を退職慰労引当金として計上している。

**(11) 外貨換算**

当社及び国内の連結子会社における外貨建資産・負債及び国外の連結子会社の財務諸表は日本の外貨建取引の会計基準に従って、以下のように換算している。

**a) 当社及び国内連結子会社における外貨建資産・負債**

原則として、貸借対照表日の為替レートで円換算している。また、為替予約契約が特定のヘッジ要件を満たしている場合には、対応する外貨建資産・負債はそれぞれの契約レートで換算されている。

**b) 国外連結子会社の財務諸表**

国外の連結子会社の資本を除く資産・負債、収益及び費用は貸借対照表日の為替レートで円換算している。資本項目は取得時又は発生時の為替レートで円換算している。為替差額は連結貸借対照表上、純資産の部における少数株主持分及び為替換算調整勘定に含めて表示している。

**(12) 法人税等**

繰延税金資産及び負債は、会計上及び税務上の資産・負債の差異に基づいて認識し、当該差異が解消されると見込まれる年度に適用される実効税率及び税法に基づいて計算している。

**(13) 一株当たり金額**

一株当たり純資産は貸借対照表日における発行済株式総数に基づいている。

一株当たり当期純利益(希薄化前)は、各年度の発行済株式総数の加重平均に基づいて計算している。一株当たり当期純利益(希薄化後)は、各年度の発行済株式総数の加重平均に基づいて、転換社債の転換及びワラントの行使があったものと仮定して計算している。

一株当たり配当金は中間配当金と前年度に対する配当金の合計を表示している。

**(14) 会計方針の変更****a) 貸借対照表の純資産の部の表示**

2007年3月31日に終了した事業年度より、当社及び国内の連結子会社は、貸借対照表の純資産の部の表示に関する新しい会計基準を適用している。

この基準を適用した場合の2006年及び2007年3月31日に終了した各事業年度の純資産の部の合計はそれぞれ46,703百万円及び54,098百万円(458,111千米ドル)である。なお、これによる2007年3月31日に終了した各事業年度の損益に与える影響は、ない。

この会計基準は、次のとおり貸借対照表を表示することを要求している。

1. 貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分される。純資産の部は、株主資本、評価・換算差額等、新株予約権及び少数株主持分に区分される。
2. 株主資本は、資本金、資本剰余金、利益剰余金及び自己株式に区分される。
3. 評価・換算差額等は、その他有価証券評価差額金、繰延ヘッジ損益及び為替換算調整勘定に区分される。

さらに、2007年3月31日に終了した事業年度から、会社は連結株主持分計算書の代わりに、連結株主資本等変動計算書の作成を要求される。この関係から、2006年3月31日に終了した事業年度の連結貸借対照表及び連結株主持分計算書は、2007年3月31日に終了した事業年度の連結財務諸表の表示として、組替表示されている。

**b) ストック・オプション等に関する会計基準等**

企業会計基準委員会は、ストック・オプション等に関する会計基準及びそれに関する適用指針を2005年12月27日に公表した。この会計基準は、2006年5月1日以降に付与されたストック・オプションに適用される。この会計基準は、ストック・オプションの付与日における公正な評価額に基づいて株式報酬費用を算定し、財貨またはサービスの対価としての勤務対象期間において、株式報酬費用を認識することを要求している。また、この会計基準は、会社の従業員でない者に対して、ストック・オプションを付与した場合も、ストック・オプションの公正な評価額または、財貨またはサービスの対価に基づいて計上することを要求している。連結貸借対照表において、ストック・オプションは権利行使されるまで、株式購入権として、資本の構成要素と区分して表示される。この会計基準は、付与した自社株式オプションや交付した自社の株式が、取得の対価として用いられることが前提となっている。

このストック・オプションに関する会計基準の適用により、2007年3月31日に終了した事業年度において税金等調整前当期純利益及び少数株主利益が183百万円(1,554千米ドル)減少している。注記事項16に記載している。

**c) 役員賞与に関する会計基準**

2007年3月31日に終了した事業年度より、当社及び国内の連結子会社は、役員賞与に関する新しい会計基準を適用している。

この会計基準は、役員賞与について、発生した会計期間において費用計上すべきことを要求している。

この会計基準の適用により、2007年3月31日に終了した事業年度において販売費及び一般管理費が59百万円（503千米ドル）増加し、税金等調整前当期純利益が59百万円（503千米ドル）減少している。

#### d) 収益計上基準

ウェーハ外観検査装置、ポリッシュ・グラインダ及びCMP装置本体の収益計上基準については、2006年3月31日に終了する事業年度までは、出荷基準によっていたが、2007年3月31日に終了した事業年度より、設置完了基準に変更している。

この変更は、これら対象製品がその他の製品と比較して、出

荷から設置完了に至る期間が比較的長期となる傾向にあること、近年において新製品として市場への浸透を図ってきたこれら対象製品の売上高に占める割合が増大してきたこと、また出荷後の業務プロセスの見直しによる設置完了に関するデータ及びシステムも整備されてきたことから、収益の実態をより適正に財務諸表に反映させるためのものである。

なお、この変更により従来基準を適用した場合に比べ2007年3月31日に終了した事業年度において、売上高、営業利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ400百万円（3,387千米ドル）、61百万円（522千米ドル）減少している。

### 3. 投資有価証券

2006年及び2007年3月31日現在の時価のある有価証券の取得原価及び時価の合計は以下のとおりである。

	百万円		千米ドル
	2006	2007	2007
取得原価	¥ 2,836	¥ <b>2,788</b>	\$ <b>23,609</b>
時価	5,097	<b>5,175</b>	<b>43,828</b>
未実現利益	¥ 2,260	¥ <b>2,387</b>	\$ <b>20,219</b>

2006年及び2007年3月31日に終了した各事業年度のその他有価証券の売却額の合計はそれぞれ1,509百万円（12,786千米ドル）及び85百万円であり、売却益の合計額はそれぞれ0

百万円（5千米ドル）及び76百万円、売却損の合計額はそれぞれ2百万円（21千米ドル）及び該当なしである。

時価のない有価証券の取得原価の合計は、2006年3月31日現在689百万円、2007年3月31日現在790百万円（6,694千米ドル）である。

#### 4. たな卸資産

2006年及び2007年3月31日現在のたな卸資産は以下のとおりである。

	百万円		千米ドル
	2006	2007	2007
商品及び製品	¥ 3,429	¥ 2,756	\$ 23,342
仕掛品	21,429	22,155	187,618
材料及び貯蔵品	2,194	2,295	19,437
	¥ 27,053	¥ 27,207	\$ 230,398

#### 5. 短期借入金及び長期債務

2006年及び2007年3月31日に終了した各事業年度の短期借入金の年間平均利率はそれぞれ0.64%及び6.48%である。

2006年及び2007年3月31日現在の長期債務は以下のとおりである。

	百万円		千米ドル
	2006	2007	2007
担保付長期債務			
銀行借入			
2006年3月31日現在、返済期限2006年、利率1.370%	¥ 750	¥ -	\$ -
無担保付長期債務			
銀行借入			
2006年3月31日現在、返済期限2006年から2010年、利率0.880%から1.600%	8,003		
2007年3月31日現在、返済期限2007年から2011年、利率0.880%から2.170%		9,280	78,588
社債			
2006年3月31日現在、償還期限2006年から2007年、利率0.910%から1.230%	1,900		
2007年3月31日現在、償還期限2007年、利率0.910%から1.230%		1,200	10,161
転換社債			
利率0.850%、償還期限2008年	51	50	423
利率0.000%、償還期限2008年	13,965	13,965	118,257
	24,669	24,495	207,430
控除：1年以内に返済期限の到来する額	3,773	4,367	36,980
	¥ 20,896	¥ 20,128	\$ 170,450

2007年3月31日において、全ての未償還の2008年償還期限0.850%転換社債が期末の転換価格（1株につき1,815円30銭（15.3米ドル）で転換された場合、当社株式は27,543

株発行される。全ての未償還の2008年償還期限0.000%転換社債が期末の転換価格（1株につき5,117円80銭（43.3米ドル）で転換された場合、当社株式は2,728,711株発行される。

2007年3月31日以降の長期債務（流動部分を含む）の年度別返済予定額は以下のとおりである。

3月31日終了年度	百万円	千米ドル
2008年	¥ 4,367	\$ 36,980
2009年	16,657	141,053
2010年	2,262	19,154
2011年	809	6,854
2012年以降	400	3,387
	¥ 24,495	\$ 207,430

当社は、運転資金の安定的かつ機動的な調達を行うため、取引金融機関との間で総額5,000百万円（42,340千米ドル）の

コミットメントライン契約を締結している。ただし、2007年3月31日現在これらの契約に基づく借入金は、ない。

## 6. 退職給付債務

当社は日本の厚生年金保険法に準拠した厚生年金従業員年金基金、非拠出型の税制適格退職年金制度及び退職金制度を採用している。国内子会社は非拠出型の税制適格年金制度及び退職金

制度を採用している。2006年及び2007年3月31日に終了した事業年度の退職給付債務、退職給付費用及び退職給付債務等の計算の基礎の内容は以下のとおりである。

### (1) 退職給付債務に関する事項

	百万円		千米ドル
	2006	2007	2007
退職給付債務	¥ 7,409	¥ 7,523	\$ 63,707
年金資産（退職給付信託を含む）	5,599	4,278	36,233
退職給付引当金	3,822	3,816	32,315
未認識数理計算上の差異	¥ (2,012)	¥ (571)	\$ (4,840)

### (2) 退職給付費用に関する事項

	百万円		千米ドル
	2006	2007	2007
勤務費用	¥ 382	¥ 360	\$ 3,054
利息費用	132	130	1,103
期待運用収益	(14)	(14)	(120)
数理計算上の差異	169	(95)	(805)
期間純退職給付費用	¥ 668	¥ 381	\$ 3,232

### (3) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

	2006	2007
割引率	2.00%	2.00%
期待運用収益率	2.50%	2.50%
退職給付費用の配分方法	定額法	定額法
未認識の数理計算上の差異の償却期間	10年	10年

取締役及び監査役に対する退職慰労引当金の合計は、2006年3月31日現在353百万円、2007年3月31日292百万円(2,480千米ドル)である。

## 7. 税金

当社及び国内の連結子会社は、その所得に対してさまざまな税金が課されており、2006年及び2007年における法定実効税率は合計でそれぞれおよそ40.69%である。国外の連結子会社の法人税等は、全体として当該国で適用される税率に基づいてい

る。2006年及び2007年3月31日に終了した事業年度の連結損益計算書の実効税率は本来の実効税率とは異なる。その差異の原因となった主な項目は以下のとおりである。

	2006	2007
法定実効税率	40.69%	<b>40.69%</b>
評価性引当額	11.59	<b>(6.87)</b>
在外連結子会社留保利益税効果額	1.81	—
自己株式処分差益に係る税額	2.30	—
試験研究費に係る法人税等の特別控除額	—	<b>(3.10)</b>
のれん償却額	—	<b>1.03</b>
その他	1.35	<b>2.02</b>
実効税率	57.74%	<b>33.77%</b>

2006年及び2007年3月31日の主要な繰延税金資産及び負債の項目は次のとおりである。

	百万円		千米ドル
	2006	2007	2007
繰延税金資産：			
退職給付引当金	¥ 2,663	¥ <b>2,661</b>	\$ <b>22,538</b>
未実現利益	557	—	—
繰越欠損金	2,431	<b>1,307</b>	<b>11,074</b>
未払賞与	352	<b>389</b>	<b>3,297</b>
子会社投資に係る将来減算一時差異	—	<b>1,554</b>	<b>13,164</b>
未払事業税	—	<b>309</b>	<b>2,617</b>
その他	788	<b>1,057</b>	<b>8,959</b>
繰延税金資産 小計	6,793	<b>7,280</b>	<b>61,652</b>
評価性引当額	(1,241)	<b>(1,860)</b>	<b>(15,753)</b>
繰延税金資産	5,551	<b>5,420</b>	<b>45,899</b>
繰延税金負債：			
退職給付信託設定益	(704)	<b>(704)</b>	<b>(5,968)</b>
固定資産圧縮積立金	(50)	<b>(48)</b>	<b>(411)</b>
在外子会社留保利益	(371)	<b>(430)</b>	<b>(3,647)</b>
その他有価証券評価差額金	(919)	<b>(971)</b>	<b>(8,228)</b>
その他	(150)	<b>(105)</b>	<b>(896)</b>
繰延税金負債	(2,196)	<b>(2,261)</b>	<b>(19,151)</b>
繰延税金資産の純額	¥ 3,355	¥ <b>3,158</b>	\$ <b>26,747</b>

## 8. 純資産

2006年4月30日まで適用されていた日本の商法（商法）は、利益準備金と資本準備金の合計額が、資本金の25%に達するまでは利益の処分として支出する金額の10%以上を利益準備金として積み立てることを規定していた。

商法は、資本準備金も利益準備金もどちらも配当として使用できないことを規定していた。しかし、いずれも株主総会の決議による欠損金の填補と取締役会の決議による資本金への組み入れができることも規定していた。

また、商法は、株主総会の決議により、資本準備金及び利益準備金の合計額が、資本金の25%を超過した場合、その超過額を株主に対する資本の払戻しまたは配当として分配できることを規定していた。

商法によると、会社の発行する普通株式は、無額面株式として規定されていた。

日本の旧商法のほとんどの規定に代わる日本の新しい会社法（会社法）は、2006年5月1日に施行された。

株主総会の決議または特定の条件を満たした場合の取締役会の決議により、いつでも分配可能限度額の範囲内で、資本剰余金と利益剰余金を原資として、株主に対して配当可能であることを規定している。

また、会社法は、資本準備金と利益準備金の合計額が、資本金の25%に達するまで、配当原資に応じて、配当額の10%と同額を資本剰余金に含まれる資本準備金が利益剰余金に含まれる利益準備金への積立を規定している。

## 9. リースに関する情報

2006年及び2007年3月31日において、オペレーションリース取引として処理されたファイナンスリース取引を、ファイナ

ンスリース取引として処理する場合のリース資産の取得原価及び減価償却累計額並びに帳簿価額は以下のとおりである。

	百万円		千米ドル
	2006	2007	2007
機械装置：			
取得価額	¥ 1,348	¥ 1,692	\$ 14,336
減価償却累計額	826	1,036	8,774
純帳簿価額	¥ 521	¥ 656	\$ 5,561
その他：			
取得価額	¥ 537	¥ 552	\$ 4,677
減価償却累計額	182	271	2,302
純帳簿価額	¥ 354	¥ 280	\$ 2,375

上記のファイナンスリース取引に関して、2006年及び2007年3月31日に終了した事業年度の支払リース料、各リー

ス期間における残存価額ゼロの定額法により計算された減価償却費相当額及び支払利息相当額は次のとおりである。

	百万円		千米ドル
	2006	2007	2007
支払リース料	¥ 730	¥ 366	\$ 3,106
減価償却費相当額	648	332	2,819
支払利息相当額	95	28	241

オペレーションリース取引として処理しているファイナンスリース取引の将来の支払リース料は次のように要約される。

	百万円		千米ドル
	2006	2007	2007
1年以内	¥ 315	¥ 385	\$ 3,265
1年超	604	589	4,995
	¥ 920	¥ 975	\$ 8,261

## 10. デリバティブ取引

当社及びその連結子会社が2006年及び2007年3月31日に保有していた全てのデリバティブ取引はヘッジ目的であるため、デリバティブ取引ごとの市場価格の関連情報は記載を要しない。

## 11. 偶発債務

偶発債務は次のとおりである。

	百万円		千米ドル
	2006	2007	2007
受取手形割引高	¥ 4,943	¥ 3,501	\$ 29,653
輸出為替手形割引高	1,270	1,714	14,516

## 12. 期末日満期手形

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理している。

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が期末残高に含まれている。

	百万円		千米ドル
	2006	2007	2007
受取手形	¥ —	¥ 270	\$ 2,286
支払手形	—	1,527	12,935

## 13. 連結損益計算書関係注記

### (1) 研究開発費

研究開発費は一般管理費と当期製造費用に含まれており、その金額は次のとおりである。

	百万円		千米ドル
	2006	2007	2007
一般管理費	¥ 1,414	¥ 748	\$ 6,336
当期製造費用	6,505	6,890	58,350

### (2) 販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費の主な内訳は次のとおりである。

	百万円		千米ドル
	2006	2007	2007
販売費			
従業員給与手当	¥ 2,004	¥ 2,125	\$ 18,002
賞与引当金繰入額	79	84	716
退職給付引当金繰入額	104	51	436
販売手数料	2,318	2,579	21,845
販売促進費	—	1,431	12,121
のれん償却額	—	80	681
一般管理費			
従業員給与手当	647	698	5,911
賞与引当金繰入額	19	27	235
役員賞与引当金繰入額	—	59	503
退職給付引当金繰入額	37	25	213
役員退職慰労引当金繰入額	18	13	111
研究開発費	1,414	—	—
のれん償却額	171	332	2,817

## 14. 希薄化前後の一株当たり純利益の差異調整

2006年及び2007年3月31日に終了した事業年度における基本的な一株当たり純利益と潜在株式調整後との差異は次のとおりである。

	百万円	千株	円	米ドル
	当期純利益	加重 平均株式数	一株当たり純利益	
2007年3月31日に終了した事業年度				
希薄化前 一株当たり純利益				
普通株式に係る純利益	¥ 8,741	40,114	¥ 217.91	\$ 1.85
希薄化株式の影響				
新株予約権	—	169		
転換社債	0	2,756		
希薄化後 一株当たり純利益	¥ 8,741	43,040	¥ 203.10	\$ 1.72
2006年3月31日に終了した事業年度				
希薄化前 一株当たり純利益				
普通株式に係る純利益	¥ 3,110	38,515	¥ 80.77	
希薄化株式の影響				
新株予約権	—	186		
転換社債	0	3,328		
希薄化後 一株当たり純利益	¥ 3,111	42,029	¥ 74.02	

## 15. 連結キャッシュ・フロー計算書関係注記

2006年及び2007年3月31日に終了した事業年度における、貸借対照表とキャッシュ・フロー計算書との現金及び現金同等物の調整は次のとおりである。

	百万円		千米ドル
	2006	2007	2007
現金及び現金同等物(貸借対照表)	¥ 13,887	¥ 16,826	\$ 142,484
マネーリザーブファンド	2	2	19
預け入れ期間が3ヶ月を超える定期預金	(38)	(28)	(237)
現金及び現金同等物(キャッシュ・フロー計算書)	¥ 13,851	¥ 16,800	\$ 142,267

### 重要な非資金取引：

(1) 当社は2005年10月に株式交換を行い、(株)東精エンジニアリングを完全子会社とした。株式交換の結果、資本準備金が6,218百万円増加している。

(2) 2006年及び2007年3月31日に終了した事業年度における、転換社債の転換の内容は次のとおりである。

	百万円		千米ドル
	2006	2007	2007
転換社債の転換による資本金の増加	¥ 1,767	¥ —	\$ —
転換社債の転換による資本準備金の増加	1,767	—	—
転換社債の減少	¥ 3,534	¥ —	\$ —

## 16. ストック・オプション情報

2006年3月31日に終了した事業年度における当期純利益には、株式報酬費用は計上されていない。一般管理費には、株式報酬費用183百万円(1,554千米ドル)が計上されている。

2007年3月31日に終了した事業年度における販売費及び一

2007年3月31日現在のストック・オプションの内容は次のとおりである。

### 第1回新株予約権

決議年月日	2002年6月27日
付与対象者及び人数	当社取締役、当社監査役、当社使用人（子会社取締役及び子会社使用人含む）：72名
株式の種類及び付与数	普通株式 170,000株
付与日	2002年9月2日
権利確定条件	付与を以って、権利確定とする。ただし、権利行使期間到来前に付与者が死亡した場合を除く。
対象勤務期間	なし
権利行使期間	2004年7月1日から2009年6月30日

### 第2回新株予約権

決議年月日	2003年6月27日
付与対象者及び人数	当社取締役、当社監査役、当社使用人（子会社取締役及び子会社使用人含む）：68名
株式の種類及び付与数	普通株式 100,000株
付与日	2003年7月30日
権利確定条件	付与を以って、権利確定とする。ただし、権利行使期間到来前に付与者が死亡した場合を除く。
対象勤務期間	なし
権利行使期間	2005年7月1日から2010年6月30日

### 第3回新株予約権

決議年月日	2004年6月29日
付与対象者及び人数	当社取締役、当社監査役、当社使用人（子会社取締役及び子会社使用人含む）：82名
株式の種類及び付与数	普通株式 200,000株
付与日	2004年9月22日
権利確定条件	権利行使時点において、当社または当社の子会社または関連会社の取締役、監査役または使用人のいずれの地位をも喪失していないこと。ただし、取締役または監査役の任期満了による退任、定年または会社都合による使用人の地位の喪失及びこれらに類する事由による場合は除く。
対象勤務期間	2004年9月22日から2006年6月30日
権利行使期間	2006年7月1日から2011年6月30日

#### 第4回新株予約権

決議年月日	2005年6月29日
付与対象者及び人数	当社取締役、当社監査役、当社使用人（子会社取締役及び子会社使用人含む）：307名
株式の種類及び付与数	普通株式 83,100株
付与日	2005年7月21日
権利確定条件	権利行使時点において、当社または当社の子会社または関連会社の取締役、監査役または使用人のいずれの地位をも喪失していないこと。ただし、取締役または監査役の任期満了による退任、定年または会社都合による使用人の地位の喪失及びこれらに類する事由による場合は除く。
対象勤務期間	2005年7月21日から2007年6月30日
権利行使期間	2007年7月1日から2012年6月30日

#### 第5回新株予約権

決議年月日	2006年6月29日
付与対象者及び人数	当社取締役、当社監査役、当社使用人（子会社取締役及び子会社使用人含む）：308名
株式の種類及び付与数	普通株式 80,500株
付与日	2006年7月25日
権利確定条件	権利行使時点において、当社または当社の子会社または関連会社の取締役、監査役または使用人のいずれの地位をも喪失していないこと。ただし、取締役または監査役の任期満了による退任、定年または会社都合による使用人の地位の喪失及びこれらに類する事由による場合は除く。
対象勤務期間	2006年7月25日から2008年7月25日
権利行使期間	2008年7月26日から2013年6月30日

#### 2005年6月発行新株予約権（株式報酬型）

決議年月日	2005年6月29日
付与対象者及び人数	当社取締役及び当社使用人（役付執行役員）：18名
株式の種類及び付与数	普通株式 47,000株
付与日	2005年6月29日
権利確定条件	原則として当社の取締役及び役付執行役員のいずれの地位をも喪失したとき。
対象勤務期間	権利確定日を合理的に予想することが困難なため、対象勤務期間をないものとみなしている。
権利行使期間	2005年6月30日から2025年6月30日

#### 2006年7月発行新株予約権（株式報酬型）

決議年月日	2006年6月29日
付与対象者及び人数	当社取締役及び当社使用人（役付執行役員）：18名
株式の種類及び付与数	普通株式 47,000株
付与日	2006年6月29日
権利確定条件	原則として当社の取締役及び役付執行役員のいずれの地位をも喪失したとき。
対象勤務期間	権利確定日を合理的に予想することが困難なため、対象勤務期間をないものとみなしている。
権利行使期間	2006年7月15日から2026年7月14日

2007年3月31日現在のストック・オプションの規模及びその変動状況は次のとおりである。

#### 権利確定前

	第1回 新株予約権	第2回 新株予約権	第3回 新株予約権	第4回 新株予約権	第5回 新株予約権
期首残高 (株)	—	—	196,000	82,800	—
付与 (株)	—	—	—	—	80,500
失効 (株)	—	—	2,000	2,600	1,500
権利確定 (株)	—	—	194,000	—	—
期末未確定残高 (株)	—	—	—	80,200	79,000

	2005年6月発行 新株予約権 (株式報酬型)	2006年7月発行 新株予約権 (株式報酬型)
期首残高 (株)	39,000	—
付与 (株)	—	29,600
失効 (株)	—	—
権利確定 (株)	—	—
期末未確定残高 (株)	39,000	29,600

#### 権利確定後

	第1回 新株予約権	第2回 新株予約権	第3回 新株予約権	第4回 新株予約権	第5回 新株予約権
期首残高 (株)	27,000	57,400	—	—	—
権利確定 (株)	—	—	194,000	—	—
権利行使 (株)	11,900	17,500	57,400	—	—
失効 (株)	—	—	—	—	—
期末未行使残高 (株)	15,100	39,900	136,600	—	—

	2005年6月発行 新株予約権 (株式報酬型)	2006年7月発行 新株予約権 (株式報酬型)
期首残高 (株)	—	—
権利確定 (株)	—	—
権利行使 (株)	—	—
失効 (株)	—	—
期末未行使残高 (株)	—	—

2007年3月31日現在のストック・オプションの単価情報は次のとおりである。

	第1回 新株予約権	第2回 新株予約権	第3回 新株予約権	第4回 新株予約権	第5回 新株予約権
権利行使価格	¥ 3,239	¥ 3,370	¥ 3,317	¥ 4,740	¥ 5,828
行使時平均株価	¥ 5,590	¥ 4,607	¥ 5,104	—	—
付与日における公正な評価単価	—	—	—	—	¥ 1,380

	2005年6月発行 新株予約権 (株式報酬型)	2006年7月発行 新株予約権 (株式報酬型)
権利行使価格	¥ 1	¥ 1
行使時平均株価	—	—
付与日における公正な評価単価	—	¥ 4,994

当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価は、次に記載の主な基礎数値に基づき、ブラック・ショールズ式を使用し、見積もっている。

	第5回 新株予約権	2006年7月発行 新株予約権 (株式報酬型)
株価変動性 (年率)	39.792 %	50.562 %
予想残存期間	4.5 年	10 年
1株当たりの予想配当	40 円	40 円
無リスクの利子率 (年率)	1.272 %	1.855 %

ストック・オプションの予想残存期間は、付与日から権利行使期間の中間点までの期間と推定して見積もっている。

## 17. セグメント情報

当社及び連結子会社は主として2つの事業セグメントにおいて製品の製造・販売を行っている。

- 1) 半導体製造装置：ウェーハブロービングマシン、ウェーハダイシングマシン、ウェーハ外観検査装置、CMP装置、ポリッシュ・グラインダ、ウェーハ製造装置等
- 2) 計測機器：三次元座標測定機、表面粗さ・輪郭形状測定機、真円度測定機、マシンコントロールゲージ等

当社及び連結子会社の2006年及び2007年3月31日に終了した事業年度の事業別セグメント、所在地別セグメント及び海外売上高の概要は以下のとおりである。

### (a) 事業別セグメント

	百万円				
	半導体 製造装置	計測機器	合計	消去又は 全社	連結
2006年3月31日に終了した事業年度					
売上高及び営業収益					
外部売上高	¥ 71,824	¥ 21,020	¥ 92,845	¥ —	¥ 92,845
セグメント間の売上高及び振替高	—	—	—	—	—
売上高合計	71,824	21,020	92,845	—	92,845
営業費用	62,852	16,000	78,853	—	78,853
営業利益	¥ 8,972	¥ 5,019	¥ 13,991	¥ —	¥ 13,991
資産、減価償却費及び資本的支出					
資産	¥ 83,885	¥ 21,256	¥ 105,141	¥ 4,733	¥ 109,875
減価償却費	2,337	430	2,768	—	2,768
資本的支出	3,399	578	3,978	—	3,978

	百万円				
	半導体 製造装置	計測機器	合計	消去又は 全社	連結
2007年3月31日に終了した事業年度					
売上高及び営業収益					
外部売上高	¥ 78,091	¥ 22,230	¥ 100,322	¥ —	¥ 100,322
セグメント間の売上高及び振替高	—	—	—	—	—
売上高合計	78,091	22,230	100,322	—	100,322
営業費用	69,261	16,974	86,236	—	86,236
営業利益	¥ 8,830	¥ 5,256	¥ 14,086	¥ —	¥ 14,086
資産、減価償却費及び資本的支出					
資産	¥ 87,583	¥ 23,470	¥ 111,054	¥ 3,777	¥ 114,831
減価償却費	2,360	521	2,882	—	2,882
資本的支出	1,500	1,010	2,511	—	2,511

	千米ドル				
	半導体 製造装置	計測機器	合計	消去又は 全社	連結
2007年3月31日に終了した事業年度					
売上高及び営業収益					
外部売上高	\$ 661,291	\$ 188,252	\$ 849,544	\$ —	\$ 849,544
セグメント間の売上高及び振替高	—	—	—	—	—
売上高合計	661,291	188,252	849,544	—	849,544
営業費用	586,518	143,740	730,258	—	730,258
営業利益	\$ 74,773	\$ 44,512	\$ 119,285	\$ —	\$ 119,285
資産、減価償却費及び資本的支出					
資産	\$ 741,670	\$ 198,751	\$ 940,422	\$ 31,985	\$ 972,407
減価償却費	19,986	4,419	24,405	—	24,405
資本的支出	12,705	8,560	21,266	—	21,266

### 会計方針の変更

2007年3月31日に終了した事業年度より、当社は、「収益認識基準」を変更し、当社及び国内子会社は、「ストック・オプション等に関する会計基準等」及び「役員賞与に関する会計基準」の適用を行っている。

これらの変更及び適用に伴い、従来の方法によった場合に比べ、「半導体製造装置」及び「計測機器」について、売上高、営業費用、営業利益がそれぞれ次のとおり増加ないし減少している。なお、資産に関する影響額は無い。

	百万円		
	半導体 製造装置	計測機器	連結
収益認識基準：			
売上高（計）	¥ (400)	¥ —	¥ (400)
営業費用	(338)	—	(338)
営業利益	(61)	—	(61)
ストック・オプション等に関する会計基準等：			
売上高（計）	—	—	—
営業費用	125	58	183
営業利益	(125)	(58)	(183)
役員賞与に関する会計基準：			
売上高（計）	—	—	—
営業費用	36	23	59
営業利益	(36)	(23)	(59)
計：			
売上高（計）	¥ (400)	¥ —	¥ (400)
営業費用	(176)	81	(95)
営業利益	(223)	(81)	(304)
	千米ドル		
	半導体 製造装置	計測機器	連結
収益認識基準：			
売上高（計）	\$ (3,387)	\$ —	\$ (3,387)
営業費用	(2,864)	—	(2,864)
営業利益	(522)	—	(522)
ストック・オプション等に関する会計基準等：			
売上高（計）	—	—	—
営業費用	1,062	492	1,554
営業利益	(1,062)	(492)	(1,554)
役員賞与に関する会計基準：			
売上高（計）	—	—	—
営業費用	306	197	503
営業利益	(306)	(197)	(503)
計：			
売上高（計）	\$ (3,387)	\$ —	\$ (3,387)
営業費用	(1,496)	689	(806)
営業利益	(1,891)	(689)	(2,580)

## (b) 所在地別セグメント

2006年3月31日に終了した事業年度	百万円					連結
	日本	米国	ドイツ	地域合計	消去又は 全社	
売上高及び営業収益						
外部売上高	¥ 78,130	¥ 9,054	¥ 5,660	¥ 92,845	¥ —	¥ 92,845
セグメント間の売上高及び振替高	9,409	—	—	9,409	(9,409)	—
売上高合計	87,539	9,054	5,660	102,254	(9,409)	92,845
営業費用	74,322	8,809	5,137	88,269	(9,415)	78,853
営業利益	¥ 13,217	¥ 244	¥ 523	¥ 13,985	¥ 6	¥ 13,991
資産	¥ 101,349	¥ 6,468	¥ 2,940	¥ 110,758	¥ (882)	¥ 109,875

2007年3月31日に終了した事業年度	百万円					連結
	日本	米国	ドイツ	地域合計	消去又は 全社	
売上高及び営業収益						
外部売上高	¥ 81,916	¥ 11,443	¥ 6,962	¥ 100,322	¥ —	¥ 100,322
セグメント間の売上高及び振替高	11,957	—	—	11,957	(11,957)	—
売上高合計	93,874	11,443	6,962	112,280	(11,957)	100,322
営業費用	80,531	11,406	6,197	98,135	(11,899)	86,236
営業利益	¥ 13,343	¥ 36	¥ 765	¥ 14,144	¥ (58)	¥ 14,086
資産	¥ 106,466	¥ 6,741	¥ 2,891	¥ 116,099	¥ (1,268)	¥ 114,831

2007年3月31日に終了した事業年度	千米ドル					連結
	日本	米国	ドイツ	地域合計	消去又は 全社	
売上高及び営業収益						
外部売上高	\$ 693,681	\$ 96,904	\$ 58,958	\$ 849,544	\$ —	\$ 849,544
セグメント間の売上高及び振替高	101,260	—	—	101,260	(101,260)	—
売上高合計	794,941	96,904	58,958	950,804	(101,260)	849,544
営業費用	681,950	96,592	52,480	831,024	(100,765)	730,258
営業利益	\$ 112,990	\$ 311	\$ 6,478	\$ 119,780	\$ (494)	\$ 119,285
資産	\$ 901,571	\$ 57,088	\$ 24,486	\$ 983,146	\$ (10,738)	\$ 972,407

### 会計方針の変更

2007年3月31日に終了した事業年度より、当社は、「収益認識基準」を変更し、当社及び国内子会社は、「ストック・オプション等に関する会計基準等」及び「役員賞与に関する会計基準」の適用を行っている。

これらの変更及び適用に伴い、従来の方法によった場合に比べ、「日本」について、売上高、営業費用、営業利益がそれぞれ次のとおり増加ないし減少している。なお、資産に関する影響額は無い。

	百万円		
	日本	消去又は 全社	連結
収益認識基準：			
売上高（計）	¥ (400)	¥ —	¥ (400)
営業費用	(338)	—	(338)
営業利益	(61)	—	(61)
ストック・オプション等に関する会計基準等：			
売上高（計）	—	—	—
営業費用	183	—	183
営業利益	(183)	—	(183)
役員賞与に関する会計基準：			
売上高（計）	—	—	—
営業費用	59	—	59
営業利益	(59)	—	(59)
計：			
売上高（計）	¥ (400)	¥ —	¥ (400)
営業費用	(95)	—	(95)
営業利益	(304)	—	(304)
	千米ドル		
	日本	消去又は 全社	連結
収益認識基準：			
売上高（計）	\$ (3,387)	\$ —	\$ (3,387)
営業費用	(2,864)	—	(2,864)
営業利益	(522)	—	(522)
ストック・オプション等に関する会計基準等：			
売上高（計）	—	—	—
営業費用	1,554	—	1,554
営業利益	(1,554)	—	(1,554)
役員賞与に関する会計基準：			
売上高（計）	—	—	—
営業費用	503	—	503
営業利益	(503)	—	(503)
計：			
売上高（計）	\$ (3,387)	\$ —	\$ (3,387)
営業費用	(806)	—	(806)
営業利益	(2,580)	—	(2,580)

**(C) 海外売上高**

当社及び国内連結子会社の海外売上高及び海外連結子会社の売上高を含む海外売上高は次のとおりである。

	百万円				
	東アジア	北米	ヨーロッパ	その他	連結
2006年3月31日に終了した事業年度					
海外売上高	¥ 31,224	¥ 7,043	¥ 5,034	¥ 4,374	¥ 47,676
連結売上高					92,845
連結売上高に占める海外売上高の割合	33.6%	7.6%	5.4%	4.7%	51.3%
	百万円				
	東アジア	北米	ヨーロッパ	その他	連結
2007年3月31日に終了した事業年度					
海外売上高	¥ 28,709	¥ 9,121	¥ 7,332	¥ 5,299	¥ 50,462
連結売上高					100,322
連結売上高に占める海外売上高の割合	28.6%	9.1%	7.3%	5.3%	50.3%
	千米ドル				
	東アジア	北米	ヨーロッパ	その他	連結
2007年3月31日に終了した事業年度					
海外売上高	\$ 243,111	\$ 77,244	\$ 62,088	\$ 44,878	\$ 427,323
連結売上高					849,544
連結売上高に占める海外売上高の割合	28.6%	9.1%	7.3%	5.3%	50.3%

**18. 後発事象**

以下の当社の剰余金の処分は2007年6月28日開催の株主総会で承認された。なお、当該剰余金処分は添付した2007年3月31日に終了した事業年度の連結財務諸表には反映されていない。

	百万円	千米ドル
事業年度末配当金（1株当たり25円=0.21米ドル）	¥ 1,003	\$ 8,501

株式会社東京精密 取締役会 御中

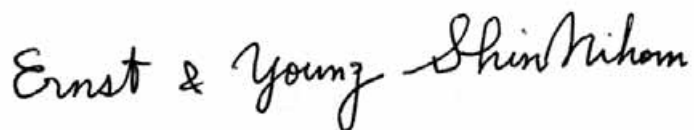
当監査法人は、添付されている株式会社東京精密及び連結子会社の日本円で表示された2006年及び2007年3月31日現在の連結貸借対照表並びに関連する同日をもって終了する各事業年度の連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書の監査を行った。これらの財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場からそれらの財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、日本において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、日本において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社東京精密及び連結子会社の2006年及び2007年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する各事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

2007年3月31日をもって終了する事業年度に関して添付されている連結財務諸表における米ドル額は、便宜上表示したにすぎない。当監査法人の監査は、日本円貨額から米ドル額への換算も含んでいる。この換算方法は連結財務諸表注記1の記載に基づいている。

新日本監査法人



2007年6月28日

## 日本

## 株式会社東京精密

本社  
〒181-8515  
東京都三鷹市下連雀9-7-1  
Tel: (0422) 48-1011  
Fax: (0422) 48-1204

## 八王子工場

〒192-0032  
東京都八王子市石川町2968-2  
Tel: (0426) 42-0381  
Fax: (0426) 42-0386

## 土浦工場

〒300-0006  
茨城県土浦市東中貫町4  
Tel: (029) 831-1234  
Fax: (029) 831-4453

## 株式会社東精エンジニアリング

本社  
〒300-0006  
茨城県土浦市東中貫町4-6  
Tel: (029) 830-1888  
Fax: (029) 830-1881

株式会社アクレーテック・  
マイクロテクノロジー

本社  
〒192-0032  
東京都八王子市石川町2968-2  
Tel: (0426) 60-5225  
Fax: (0426) 60-5226

## 株式会社トーセシステムズ

本社  
〒192-0032  
東京都八王子市石川町2968-2  
Tel: (0426) 45-1911  
Fax: (0426) 45-1942

## 株式会社アクレーテック・クリエイト

本社  
〒181-8515  
東京都三鷹市下連雀9-7-1  
Tel: (0422) 48-1011  
Fax: (0422) 49-7068

株式会社アクレーテック・  
ファイナンス

本社  
〒181-8515  
東京都三鷹市下連雀9-7-1  
Tel: (0422) 48-1011  
Fax: (0422) 42-3816

## 株式会社東精ボックス

本社  
〒192-0032  
東京都八王子市石川町2968-2  
Tel: (0426) 60-0845  
Fax: (0426) 60-0965

## 北米

## 米国

**Accretech USA, Inc.**  
Corporate Head Office  
2600 Telegraph Rd., Suite 180,  
Bloomfield Hills, MI 48302, U.S.A.  
Tel: 1 (248) 332-0100  
Fax: 1 (248) 332-0700

SEMICONDUCTOR EQUIPMENT  
SECTOR (SES)

Austin Office  
3500 Wadley Place, Building A,  
Austin, TX 78728, U.S.A.  
Tel: 1 (512) 246-4500  
Fax: 1 (512) 246-4501

Milpitas Office  
1765 S. Main Street, Suite 121,  
Milpitas, CA 95035, U.S.A.  
Tel: 1 (408) 719-2400  
Fax: 1 (408) 719-2401

Dallas Office  
3400 Waterview Parkway, Suite  
109, Richardson, TX 75080, U.S.A.  
Tel: 1 (972) 735-0880  
Fax: 1 (972) 735-0890

Boise Office  
800 E. Citation Court, Suite A,  
Boise, ID 83716, U.S.A.  
Tel: 1 (208) 429-6500  
Fax: 1 (208) 429-6555

WAFER MANUFACTURING  
SECTOR (WMS)

Austin Office  
3500 Wadley Place, Building A,  
Austin, TX 78728, U.S.A.  
Tel: 1 (512) 246-4500  
Fax: 1 (512) 246-4501

New Jersey Office  
6E Frassetto Way, Lincoln Park,  
NJ 07035, U.S.A.  
Tel: 1 (973) 872-4733  
Fax: 1 (973) 872-4744

METROLOGY EQUIPMENT  
SECTOR (MES)

Detroit Office  
37735 Enterprise Court, Suite  
400, Farmington Hills, MI 48331,  
U.S.A.  
Tel: 1 (248) 489-5500  
Fax: 1 (248) 489-5503

Atlanta Office  
3114 Walton Way, Roswell,  
GA 30076, U.S.A.  
Tel: 1 (248) 417-9126  
Fax: 1 (248) 489-5503

## ヨーロッパ

## ドイツ

**Accretech (Europe) GmbH**  
Head Office  
Landsberger Str. 396, D-81241  
Munich, Germany  
Tel: 49 (89) 546788-0  
Fax: 49 (89) 546788-10

Dresden Office  
Zur Wetterwarte 10, Geb. 104,  
EG, D-01109 Dresden, Germany  
Tel: 49 (351) 89024-11  
Fax: 49 (351) 89024-12

## フランス

French Office  
223 rue des Becasses, F-38920  
Crolles, France  
Tel: 33 (476) 04-4080  
Fax: 33 (476) 04-0730

## イタリア

Milan Office  
Via Roggia Renatella 2/A,  
Cernusco s/N, I-20063 Milan, Italy  
Tel: 39 (2) 92112357  
Fax: 39 (2) 92111477

## アジア

## 中国

**Accretech (China) Co., Ltd.**  
Head Office  
Room 12B05, Marine Tower,  
1 Pudong Ave, Shanghai 200120,  
China  
Tel: 86 (21) 3887-0801  
Fax: 86 (21) 3887-0805

Beijing Office  
11E# Office Building, No. 48,  
Dong Zhi Men Wai, Dong Cheng  
District, Beijing 100027, China  
Tel: 86 (10) 8447-7011  
Fax: 86 (10) 8447-7010

Shenzhen Office  
Room 2409, Golden Business  
Center, No. 2028 Shennan Road  
East, Shenzhen, Guangdong  
Province 518001, China  
Tel: 86 (755) 2515-9842  
Fax: 86 (755) 2515-7737

Guangzhou Office  
Room 1907, East Tower, Yang  
Cheng International Commercial  
Center, 122 Ti Yu Dong Road,  
Tian He District, Guangzhou,  
Guangdong Province 510620,  
China  
Tel: 86 (20) 3887-0975  
Fax: 86 (20) 3887-0627

Chongqing Office  
21-FA3, Chongqing Lanko Hyatt  
Building, 2 Nanping West Road,  
Nanan District, Chongqing  
400060, China  
Tel: 86 (23) 6295-5061  
Fax: 86 (23) 6295-5060

Changchun Office  
Room 708, Tower A, Zhongyin  
Building, No.727 XiAn Road,  
Changchun, Jilin Province  
130061, China  
Tel: 86 (431) 8896 1051  
Fax: 86 (431) 8896 0661

Suzhou Office  
Room 2001, NO.11, Jiacheng  
Garden, No.85 Xinghan Road,  
Industry Area Suzhou, Suzhou  
City, Province Jiangsu 215021,  
China  
Tel: 86 (512) 6265 6436  
Fax: 86 (512) 6265 6435

Tianjin Office  
Room 1503, Brilliant Crystal Tower,  
53-1 Weidi Road, Hexi District,  
Tianjin City 300201, China  
Tel: 86 (22) 8822 7220  
Fax: 86 (22) 2833 2125

Tosei Measuring (Pinghu) Co.,  
Ltd.

No. 666, Xingping Second Road,  
Economic Development Zone,  
Pinghu, Zhejiang 314200, China  
Tel: 86 (573) 509-0102  
Fax: 86 (573) 509-0304

Sanmenxia Zhongyuan  
Tokyo Seimitsu Co., Ltd.

9 Western End of Heping Road,  
Sanmenxia, Henan 472000, China  
Tel: 86 (398) 285-4108  
86 (398) 285-4208  
Fax: 86 (398) 282-1510  
86 (398) 285-4208

## 韓国

**Accretech Korea Co., Ltd.**  
3rd Fl. Fine Venture Bldg., 345-1  
Yatap-dong, Bundang-gu,  
Seongnam-si, Gyeonggi-do,  
463-828 Korea  
Tel: 82 (31) 786 4000  
Fax: 82 (31) 786 4090

**Tosei Korea Co., Ltd.**  
B-511, Lion's Valley 371-28,  
Gasam-Dong Geumcheon-Gu,  
Seoul, 153-786, Korea  
Tel: 82 (2) 2026-5543  
Fax: 82 (2) 2026-5543

## 台湾

**Tokyo Seimitsu Co., Ltd.**  
**Accretech Technical Center Taiwan**  
No.95, Shuiyuan St., Hsinchu  
30069, Taiwan  
Tel: 886 (3) 573 9000  
Fax: 886 (3) 573 0606

## マレーシア

**Accretech (Malaysia) Sdn. Bhd.**  
Head Office  
39 Jalan PJS 11/2, 46000  
Subang Indah, Petaling Jaya,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  
Tel: 60 (3) 5632-7488  
Fax: 60 (3) 5632-7489

Kulim Office  
464, Lorong Keranji 9/3, Taman  
Keranji Bukit Kulim, 09000 Kulim,  
Kedah, Malaysia  
Tel: 60 (4) 4930082  
Fax: 60 (4) 4930082

## シンガポール

**Accretech (Singapore) Pte. Ltd.**  
10 Ubi, Crescent #05-92/93/94/95  
Lobby E, Ubi Techpark 408564,  
Singapore  
Tel: 65 (6741) 1712  
Fax: 65 (6382) 1123

## タイ

**Tosei (Thailand) Co., Ltd.**  
40/14 Moo 12, Bangna Towers C,  
16th Floor Bangna-Trad Road,  
K.M. 6.5, Bangkaew, Bangplee,  
Samutprakarn 10540, Thailand  
Tel: 66 (0) 2751-9563  
Fax: 66 (0) 2751-9564

(2007年7月現在)

**本社所在地：**

〒181-8515 東京都三鷹市下連雀9-7-1  
Tel：(0422) 48-1011  
Fax：(0422) 48-1204

**設立：**

1949年3月28日

**資本金：**

9,592百万円

**従業員数：**

連結：1,235名  
個別：665名

**株式：**

授權資本：110,501,100株  
発行済株式：40,187,517株（うち、自己株式数28,215株）

**総株主数：**

27,889名

**上場証券取引所：**

東京証券取引所 市場第一部（証券コード 7729）

**大株主：**

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）  
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）  
財団法人精密測定技術振興財団  
株式会社みずほコーポレート銀行  
ゴールドマン・サックス・インターナショナル

**株主名簿管理人：**

みずほ信託銀行株式会社  
〒103-8670 東京都中央区八重洲1-2-1

**定時株主総会：**

毎年6月中 基準日3月31日

**独立監査人：**

新日本監査法人

**お問い合わせ先：**

業務会社広報・IR室  
Tel：(0422) 48-1011  
Fax：(0422) 45-3636  
E-mail：ir@accretech.jp

(2007年3月31日現在)

## 株式会社東京精密

〒181-8515 東京都三鷹市下連雀9-7-1

Tel: (0422) 48-1011

Fax: (0422) 48-1204

<http://www.accretech.jp>



このアニュアルレポートは再生紙を使用しております。  
Printed in Japan